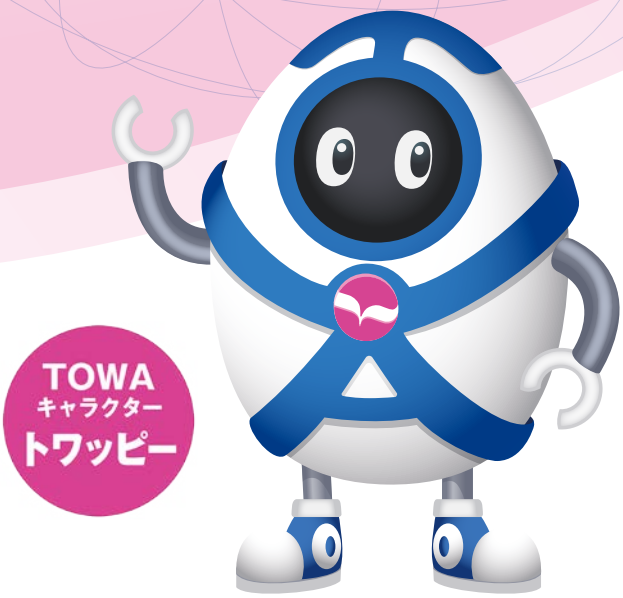
TOWA

統合報告書
2024



未来を創造する世界最先端のイノベーションカンパニーへ！

1979年の創業から業界の常識にとらわれない斬新な技術を生み出し、
さまざまな課題と真剣に向き合ってきたTOWA。
培ってきた技術で未来を創造し、「変革で世界の頂」を目指します。

2022/4 ～ 2025/3
第一次中期経営計画

「世界の頂」への
基盤強化

売上高
600億円

2025/4 ～ 2028/3
第二次中期経営計画

新たな課題への
挑戦と飛躍

売上高
760億円

経営理念

産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、
クォーター・リードに徹した「新製品・新商品」の創成に向けて、
果敢なる挑戦のもと、全力を傾注して成果を生み出し、
もって産業の発展に多大の貢献をはたす。

TOWAビジョン2032

変革で世界の頂へ

詳しくはP.21

2028/4 ～ 2032/3
第三次中期経営計画

売上1,000億円と高利益率の達成

売上高
1,000億円

表紙のキャラクター紹介

トワッピー

長期ビジョン「TOWA ビジョン2032」達成に向けたメッセージを広く内外に発信するため、キャラクター「トワッピー」を制作しました。

プロフィールなど詳しくはP.49

ありたい姿

1. パッケージングプロセス提案により顧客価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニー
2. TOWAの技術でサステナブルな社会を実現する会社
3. 積極的な情報発信で知名度の高い会社
4. 企業文化の伝承と多様な価値観を尊重する笑顔で働ける会社

経営の基本方針

TOWAグループは、超精密金型を創り出してきた「金型関連技術」が当社のコア・コンピタンスであると考えております。
この原点に立ち戻って、コア・コンピタンスを活かした事業領域に経営資源を集中し、QCD（Quality品質・Cost原価・Delivery納期）の最適化を図り、収益体質を確立してまいります。
また、「薄型化・微細化・多段化」をテーマに技術革新が続く半導体パッケージ技術の未来を見据え、市場ニーズを先取りするソリューション提案型の開発・生産・販売戦略に取り組んでまいります。

2024の編集ポイント

ポイント 1

長期ビジョン達成に向けた基盤強化期間としての進捗

2022年に発表した「TOWAビジョン2032」の達成に向けて、“「世界の頂」への基盤強化”の期間としての新技術・新規装置開発や設備投資、人的資本に関する取り組みを掲載しています。

ポイント 2

市場優位性のある技術情報を特集1、2として掲載

積み重ねてきた技術革新“モールディング革命”、および超高速メモリHBMなど最先端半導体に貢献するTOWAグループの技術をすべての読者へ分かりやすく解説しております。

ポイント 3

社外からの提言となる社外取締役座談会を実施

当社3名の社外取締役による座談会を開催。TOWAの経営のあり方に対して多様な意見が交わされ、グループの成長へ抱く期待などが語られた様子を掲載しています。

ポイント 4

ESG情報の拡充

気候変動対策における当社グループのScope3排出量算定や、人的資本への取り組みなど、ESG情報の開示拡充に努めました。

編集方針

TOWAグループは、2022年度より財務活動と非財務活動を統合的にご覧いただくための報告書を発行しております。このたび発行いたしました「TOWA統合報告書2024」におきましては、当社グループの経営上のミッションである「技術水準向上へのあくなき追求」を目指す戦略ストーリーについて、当社グループのマテリアリティおよびビジネスモデルとともに、ステークホルダーの皆様に分かりやすくご理解いただけるよう心掛けて編集いたしました。

今年度は、社外取締役鼎談を開催し、社外取締役の生の声や見解、取締役会での議論の状況を紹介いたしました。TOWAグループの価値向上に向けた課題や展望について議論をいたしております。

ステークホルダーの皆様との対話は、当社グループの持続的成長にとって必要不可欠であります。本報告書をご高覧頂き、忌憚のないご意見を賜れば幸いです。

報告対象期間

2023年度（2023年4月1日～ 2024年3月31日）を対象としていますが、それ以前、以後の情報も掲載しております。

報告対象範囲

当社およびグループ会社

将来の見通しに関する注意事項

本報告書に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、作成時点で入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、不確定な要素を含んでいます。実際の業績などはさまざまな要因により、見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知ください。

CONTENTS

1 プロフィール

1 経営理念・経営の基本方針
3 編集方針
4 目次
5 TOWAグループの事業内容
7 TOWAグループの歴史

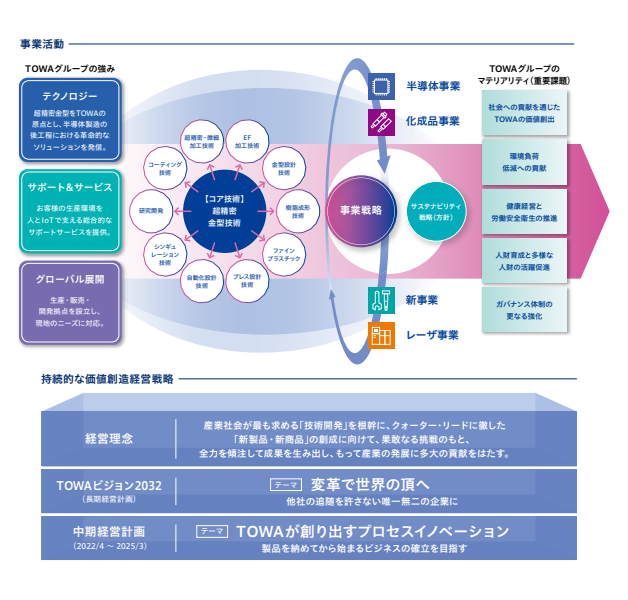
CHAPTER 01

9 トップメッセージ

CHAPTER 02

13 価値創造ストーリー

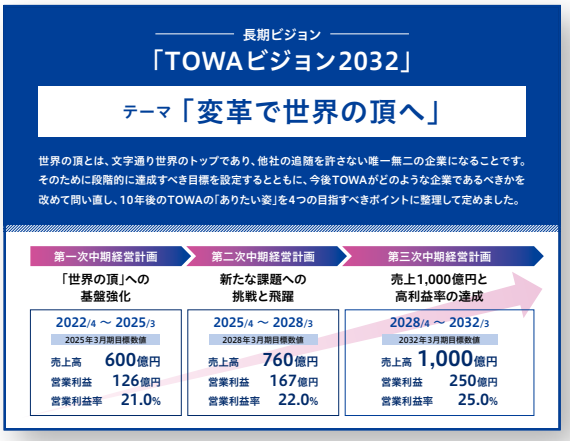
13 TOWAグループの価値創造プロセス
15 TOWAグループの培った強み
17 TOWAグループの技術と製品
19 TOWAグループのマテリアリティ



CHAPTER 03

21 価値創造の戦略

21 長期ビジョン「TOWAビジョン2032」
23 第一次中期経営計画の進捗（2022/4 ～ 2025/3）
27 特集1 戦略的技術
29 特集2 戦略的技術
31 半導体事業
33 新事業
34 化成品事業
34 レーザ事業



CHAPTER 04

35 価値創造の基盤

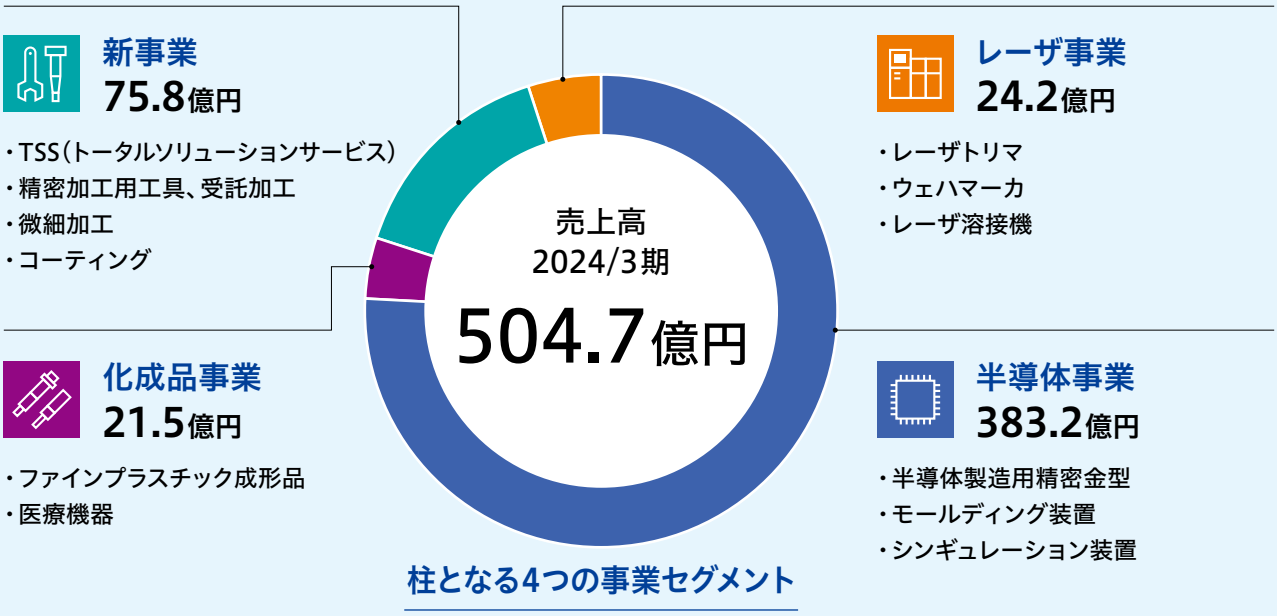
35 特集3 社外取締役座談会
39 TOWAグループのサステナビリティ
41 TOWAグループの環境への取り組み
45 TOWAグループの社会への取り組み
51 TOWAグループのコーポレートガバナンス
55 役員一覧

57 財務情報・会社概要

57 財務・非財務ハイライト
59 財務情報
61 グローバルネットワーク
62 会社概要

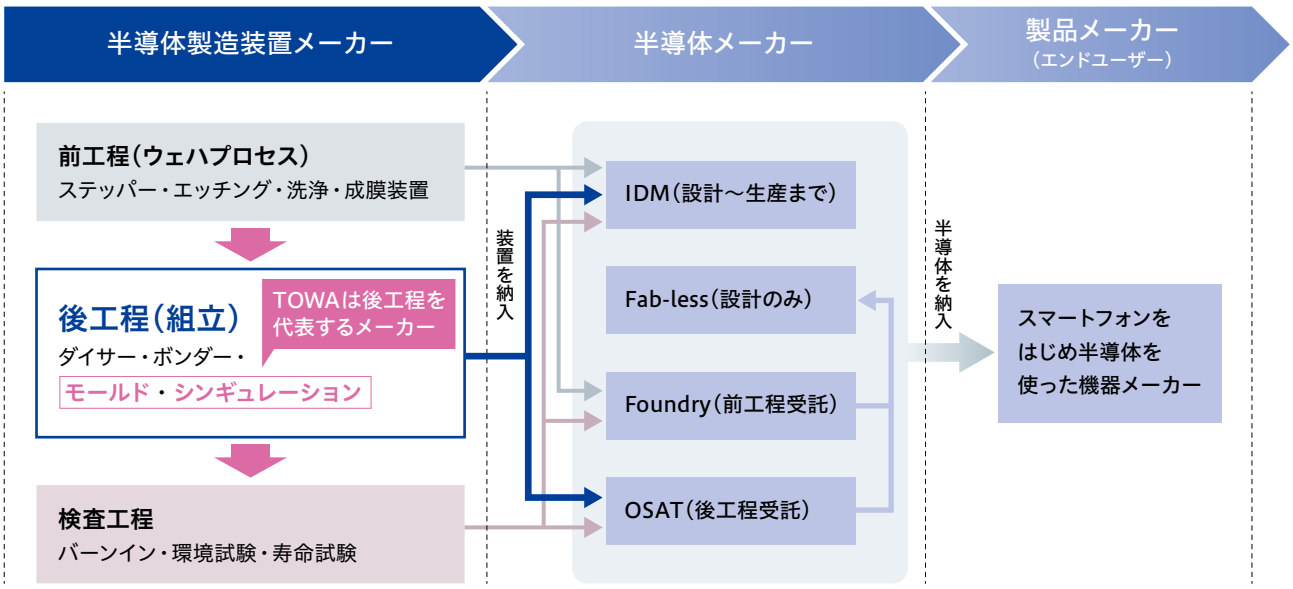
TOWAグループの事業内容

創業以来、TOWAは技術開発型企業としてものづくりにおけるニーズを汲みとり、デファクトスタンダードを生み出してきました。現在、半導体事業を中心として、4つのセグメントを柱に、世界で事業を展開しています。



半導体製造におけるTOWAグループの立ち位置

半導体装置メーカーは、前工程・後工程・検査工程の各専用装置で住み分けされており、装置を半導体メーカーに納入します。半導体メーカーは装置メーカーの装置を使って半導体を製造し、半導体を使った製品をつくるメーカーに納入します。TOWAグループは後工程の半導体装置メーカーに属します。



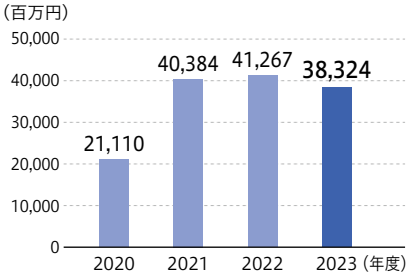
各セグメント事業の紹介

	事業紹介	売上高実績

半導体事業

当社グループの中心をなす事業です。半導体を保護する樹脂にて半導体を封止するモールディング装置や金型、個片化のためのシンギュレーション装置を製造しています。

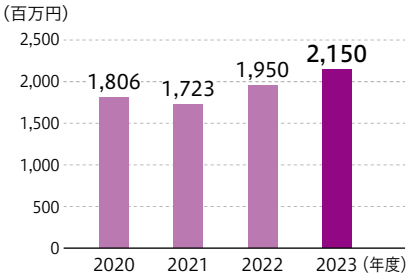
詳細はP.31



化成品事業

金型製造で培った超精密微細加工技術を活かしてプラスチック製品の成形・組立を一貫して行っています。主に医療機器の製造が中心となっています。

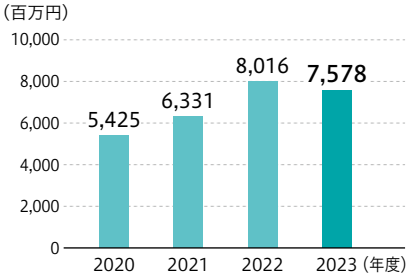
詳細はP.34



新事業

超精密金型製造で培ったコア技術をもとにした工具の販売、受託加工ビジネスや、部品供給、修理、改造、付加価値提案などトータルなサポートサービスを行っています。

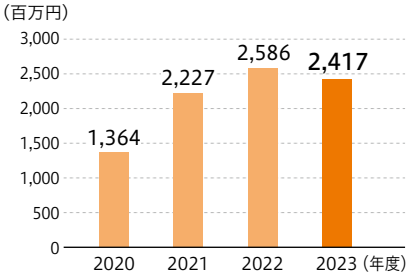
詳細はP.33



レーザ事業

抵抗値を調整するレーザトリミング装置やウェハに管理番号をマーキングするウェハマーキング装置等を製造しています。

詳細はP.34



TOWAグループの歴史

TOWAは、勃興期の半導体産業と共に歩んできました。当社の歴史は技術革命の歴史であり、1979年の創業から、エポックメイキングな技術革命を通して成長を続けてまいりました。その端緒を開いたのがマルチプランジャの開発です。以来、常にこの業界で先陣を切って新技術、新製品を世に生み出し続けています。

1979

第1次モールディング革命

業界標準の確立

▶マルチプランジャの開発

技術革命 1

マルチプランジャモールドの登場

複数の小サイズ樹脂を注入する自動成形方式で、流路短縮により品質向上と廃棄樹脂低減を実現しました。

マルチプランジャ金型

1995

第2次モールディング革命

Yシリーズの爆発的ヒット

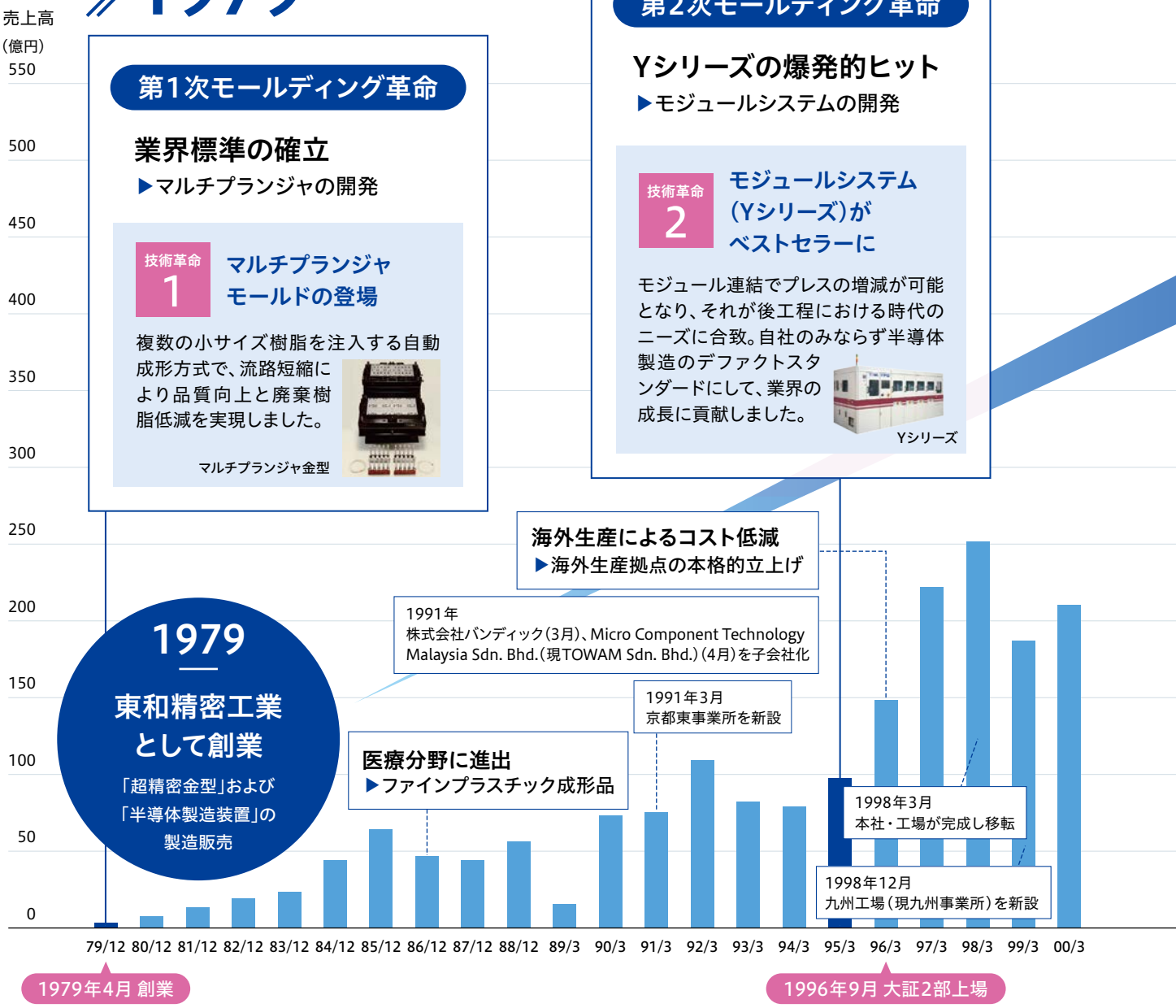
▶モジュールシステムの開発

技術革命 2

モジュールシステム（Yシリーズ）がベストセラーに

モジュール連結でプレスの増減が可能となり、それが後工程における時代のニーズに合致。自社のみならず半導体製造のデファクトスタンダードにして、業界の成長に貢献しました。

Yシリーズ



2032

変革で世界の頂へ

他社の追随を許さない
唯一無二の企業

2009

第3次モールディング革命

新たな業界標準の確立
▶コンプレッション装置の市場投入

技術革命 3
コンプレッション成形方式で最先端製品に対応

TOWA独自のコンプレッション（圧縮）成形方式により、樹脂流動が無く最先端製品の成形を可能に。低コスト化、CO_2削減にも貢献します。

Model PMC1040-S

グローバル・サービス体制の確立
▶海外各拠点でフィールドサービスを開始

ブレード事業をM&A
▶消耗品ビジネスの本格展開

レーザ加工装置事業をM&A
中国金型事業をM&A

Samsung子会社のモールド事業をM&A
▶Samsung第1ベンダーの地位を獲得

2023年3月
マレーシアにTOWA TOOL SDN. BHD. を設立し、4月にK-Tool Engineering Sdn. Bhd. の金型製造事業を譲受

2015年10月
TOWA韓国がSEMES Co.,Ltd. のモールディング事業を譲受

2013年4月
ソウルにTOWA韓国株式会社を設立

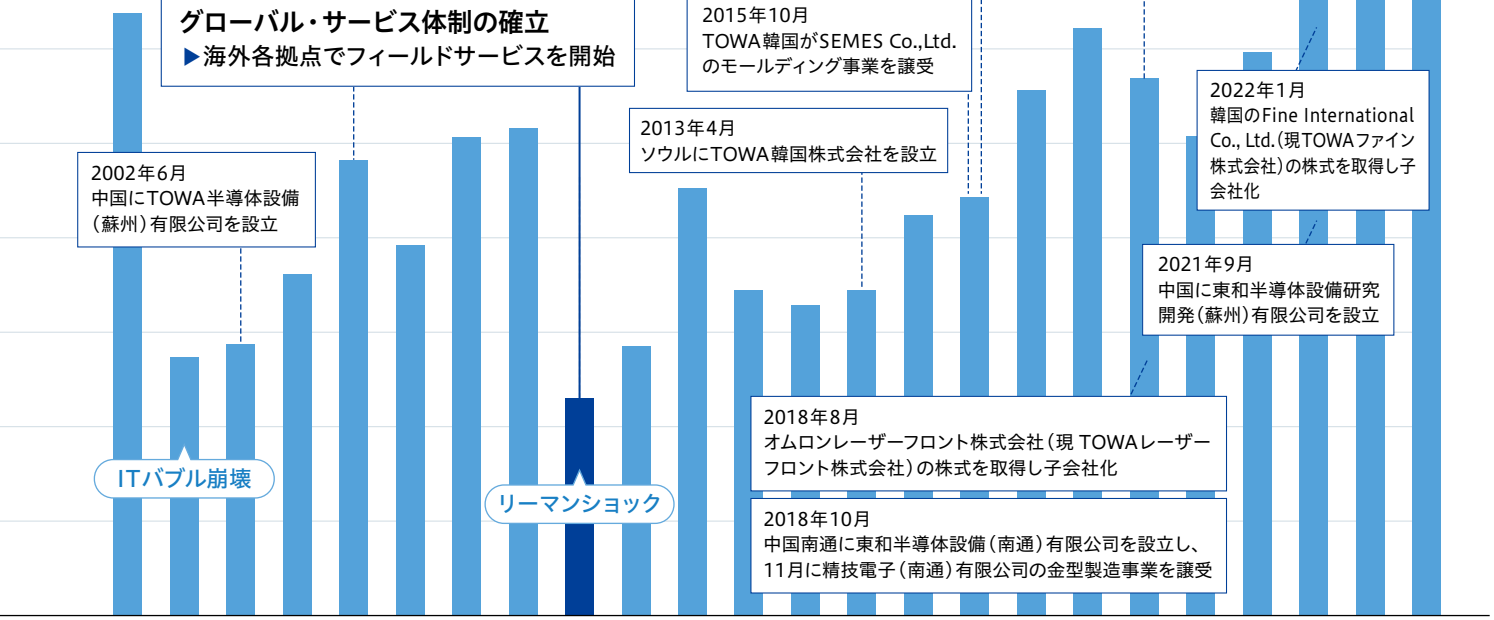
2002年6月
中国にTOWA半導体設備（蘇州）有限公司を設立

2022年1月
韓国のFine International Co., Ltd.（現TOWAファイン株式会社）の株式を取得し子会社化

2021年9月
中国に東和半導体設備研究開発（蘇州）有限公司を設立

2018年8月
オムロンレーザーフロント株式会社（現 TOWAレーザーフロント株式会社）の株式を取得し子会社化

2018年10月
中国南通に東和半導体設備（南通）有限公司を設立し、11月に精技電子（南通）有限公司の金型製造事業を譲受



2000年11月 東証1部上場
2014年3月 TOWA10年ビジョン発表
2022年3月 長期ビジョン「TOWAビジョン2032」発表

CHAPTER 01

TOP MESSAGE

代表取締役社長
岡田 博和

半導体製造の新たな潮流にいち早く対応し、先端半導体の普及に大きく貢献してまいります

HBMの製造で不可欠なコンプレッション装置の受注、売上高が過去最高を更新

近年、半導体の先端技術分野では微細化がさらに加速する一方で、製品の歩留まりや製造コストなどの課題を背景に、3次元(3D)実装などの技術が急速に進歩しております。その代表的な半導体であるHigh Bandwidth Memory(HBM=広帯域メモリ)はきわめて広い帯域幅、すなわち超高速のデータ転送を強みに、これからの時代におけるITの主役ともいえる生成AIの普及になくてはならない製品です。

TOWAは、このHBMの量産において、樹脂封止で必須とされるコンプレッション方式の装置を製造している世界で唯一のメーカーです。

現在、TOWAは半導体製造の後工程に欠かせない封止装置のメーカーとして、金額ベースで66%という高いシェアを獲得しています。半導体を製品とするには、最後に半導体チップをほこりや衝撃などから保護するために樹脂で封止する加工が必要となります。従来は、溶かした樹脂を流し込むトランスファと呼ばれる方式が一般的であり、この分野でも当社はリーディングカンパニーの地位を占めてきました。

さらに、当社は溶かした樹脂に半導体を漬け込み成形するコンプレッション方式の画期的な封止プロセスを確立しました。ハイエンドな半導体の製造に欠かせない同方式の装置はTOWAが2009年にリリースして以降、追随した競合がいまだに登場しておりません。2023年春以降、HBM向けのコンプレッション装置に対する需要が急激に高まっている中で、受注が急増している状況です。2024年3月期においては、コンプレッション装置の受注、売上高ともに過去最高を更新しました。

TOWAでは数年前からお客様の要請のもとでHBMに関連した封止技術の開発を周到に進め、半導体の新たな

潮流に向けて着々と備えてきました。そして、生成AIというイベントに対して満を持して販売拡大に取り組み中です。一躍脚光を浴びているHBMの製造は2025年から各社で本格化することから、商談がさらに活発なものとなっています。

HBMに加えてチップレットの製造でもTOWAのプロセス技術が貢献

HBMの製造において、TOWAの独自技術であるコンプレッション方式の装置がなぜ必須なのかと申しますと、HBMの特長の一つである垂直方向のメモリ積層が大きな理由です。3D技術を活用して、当初は4層のメモリチップから始まり、それが8層、12層、さらに今後は16層というように積層化が急速に進歩しています。

コンプレッション方式および高度な真空技術を含めたプロセス技術を実現したことで、今後普及が進むHBMの製造を可能にしたわけです。多くの半導体メーカー様からは「HBMの封止加工ではTOWAのコンプレッション方式が最適。他社製では課題であった製品の歩留まりが画期的に改善した。」とのお墨付きをいただいております。

HBMの製造ではコンプレッション方式の装置が注目されていますが、今後本格化していくチップレットと呼ばれる半導体の新たな製造技術においては、「レジンフローコントロール方式」という技術を開発し、トランスファ装置で独自のプロセスの提案を行っています。従来の高性能な半導体は一つのチップに膨大な回路を集積していたのに対して、チップレット技術による半導体は、回路を複数のチップに分けて、それらを基板上に配置して大規模回路とします。チップレット技術によって製造時の歩留まりを改善でき、製造コストを低減することができます。

折しも2024年6月、生成AI向け半導体の生産向けに開発したモールディング装置が、産業タイムズ社主催の「半導体・オブ・ザ・イヤー2024」の半導体製造装置部門にてグランプリを受賞しました。今後、高い成長が見込まれるチップレット製品に対応した業界初の装置として、半導体市場のニーズに応える新製品である点が高く評価されたものです。

付加価値の高いコンプレッション装置の販売比率が向上

2024年3月期につきまして、半導体市場が調整局面に入ったことから業界全体として投資抑制が続きました。そのため、当初計画の売上高を570億円から510億円に、営業利益を124億円から81億円に変更しました。これに対して実績としては、売上高が504億円と6億円ほど期初計画に対して未達だったものの、営業利益については86億円と上回ることができました。営業利益率は17%と高い水準を維持しています。コンプレッション装置、金型の受注・売上がともに過去最高を更新したとともに、製品ミックスの改善が進んだことが主な理由です。

2025年3月期の通期業績予想は、売上高600億円、営業利益126億円の大幅な増収増益を見込んでいます。この要因として付加価値の高いコンプレッション装置の販売比率と販売台数の増加を想定しており、営業利益率は21%に向上する見込みです。

第1四半期から販売は順調に滑り出しており、計画の必達に向けて取り組みを強化しているところです。私としては、2032年の目標売上高1,000億円に向けて売上を着実に伸ばすとともに、営業利益率20%以上を達成していくことが使命と考えております。

地域ごとのリスクに配慮しつつ全方位で事業を展開

TOWAの地域展開の現状と今後についてお伝えしますと、基本的に地産地消の考えのもとで、地域のお客様のニーズに即した事業を展開しています。現時点で中国での売上比率が最も高く、直近で全体の34%を占めています。近年は既存の半導体メーカーとの取引にとどまらず、ファウンドリと呼ばれる半導体受託製造会社とのつながりも深くなってきています。2021年に中国の国内に開発拠点を設け、技術開発から製造、販売、アフターサポートまで一貫して即応できる体制を整えたことが大きな要因であり、お客様から高く評価されております。将来に向けて最新の情報がTOWAに一番先に入ってくることから、何事も先手先手で対処できることが事業展開における強みとなっています。

TOWAでは中国をはじめ、東南アジア、韓国、台湾、欧米と、地域ごとのリスクに常に配慮しつつ全方位で地域展開を進めているところです。その中で日本の位置づけですが、新技術、新製品の開発拠点であり続けます。加えて、日本国

内での半導体製造に関する動きが複数出ており、こうした動向にも的確に対処していきます。

地域として新たに着目しているのがインドです。現状ではシンガポールやマレーシアの拠点を通じて対応しています。今後、インドは国をあげて半導体産業の育成に力を入れていくことから、数年先には市場として本格的に立ち上がっていくと予想しています。2023年に初めてインドを視察して、半導体業界の周辺メーカーが早くも動き出している様を自らの目で確認しました。インドは既存の市場に置き換わる存在ではなく、プラスアルファとしての市場になるととらえており、TOWAとしても新たな市場機会の獲得に向けて取り組んでいきます。

このほか、欧州および北米については現状で売上が合わせて2%にとどまっているものの、一部で現地での半導体生産を模索する動きが出ていることから情報収集に努め、機を逃すことなく対応していく考えです。

超高速の利点からHBMがメモリの主役になる可能性

2023年度は半導体の市況が低迷し、その影響は2024年に入っても続いています。ようやく回復の兆しがあり、下半期以降、需要の回復を期待しているところです。こうした短期的なトレンドに加えて、私が注視しているのが従来のDDR規格からHBMに置き換わる可能性です。個人的にはその可能性が徐々に高まっていると感じています。

データセンターをはじめとしてすべての場面で処理速度の重視が加速する中でHBMの需要は大きく伸びると見込んでおり、それにともないTOWAに対する期待もさらにふくらむものと考えます。そのため、コンプレッション装置をはじめとしてお客様のニーズに即した製品とソリューションの提供にしっかり注力してまいります。

コンプレッション方式を中心としたモールディング装置の拡販と併せて、2024年度の課題がシンギュレーション装置の販売拡大です。樹脂封止した半導体チップを個片化して収納する同装置は当社が1990年代から半導体メーカーの依頼で開発して技術を磨いてきました。現状の営業体制ではモールディング装置の販売が重視されがちでしたので、2023年10月に組織を一新し、開発・生産・営業を一体とする事業本部制としてシンギュレーション事業本部を立ち上げました。

また、シンギュレーションについてはレーザー技術との融合を図るなど新たな挑戦を進めており、モールディングと同様に革新的なソリューションの提案を通じて、新たな収益機会を生み出していく考えです。

なお、TOWAにおけるビジネスの強みは持続的な技術革新とともに、お客様のそばに常に寄り添い、課題の解決に注力するサポート&サービスにもあります。装置を納めて終わりではなく、むしろその後の点検をはじめ、トラブルシュート、生産性向上に向けた改善、部品供給、付加価値の提案といった取り組みこそTOWAの真価であります。サービスエンジニアがお客様のもとを訪問した際、たとえ自らが担当する装置以外でもお客様のお困りごとに真摯に対応しています。一人ひとりがお客様との対話を大切にするとともに、課題の解決に向けて最適の提案に注力する。こうしたサービスの姿勢もまた製品を導入していただいた世界中のお客様から信頼されている理由と考えます。

失敗を恐れることなく挑戦し続けることが新たな価値の創出につながっていく

振り返って思うこととして、常に挑戦し続ける情熱こそTOWAにおける成長の原動力であります。たとえ小さな課題にも挑戦することで、成長の芽を生み出し育てていく。そこにTOWAの価値の源泉があると信じております。

新しいことに挑戦する上では失敗がつきものですが、私は社内に向けて「挑戦することでのトラブルはウエルカム」と常々申しています。

過去においては、私自身、手痛い失敗を通じて学んだことがたくさんあります。今だからこそ話せるのですが、シンガポールに駐在していた頃、ある装置をお客様に納めたところ大きなトラブルを起こしまして、お客様からたいへんなお叱りを受けました。

その後、問題点をただちに洗い出し、改善案を提案しました。それによって「生産性や品質が間違いなく向上します」と断言して、お客様のご理解の上で対策を講じたのです。結果として提案した通りの成果を上げたことで、最終的にはお客様から高く評価していただきました。失敗から逃げることなく踏みとどまって、一歩踏み込んだ提案を心がけたことが成果につながり、お客様との関係もより深いものとなったと考えます。

もちろん、仕事で失敗がないのに越したことはないものの、だからといって成功間違いなしの仕事ばかりでは新たな

価値を生み出すことはできません。ほかでは真似のできない価値の創出を目指す上では、これから先も「挑戦することでのトラブルはウエルカム」の精神で挑戦する姿勢が欠かせないと考えます。

第四次モールディング革命を起こし更なる成長を目指す

長期ビジョンの見通しについて考えをお伝えします。2032年の売上目標1,000億円に向けては、新たな生産拠点の確保を含めて、生産体制の強化を進めています。2024年4月に韓国の工場を取得した結果、現時点で約800億円の受注に対応できる生産体制を整えました。加えて、中国においては蘇州および南通の工場で増設の余地があり、2032年の目標達成に向けては生産体制のさらなる拡充を着実に進めております。

そして、TOWAは競争優位をさらに高めていくための挑戦を続けています。具体的には、我々の強みを更に進化させて封止プロセスの高付加価値化や高度化に寄与していきます。私の思いとしては、封止プロセスにプラスアルファのアイデアを付加することで、たとえば封止コストを半減することを狙っています。技術開発にはなお時間がかかるものの、方向性はすでに見えていることから、ぜひとも実現していく考えです。これによって、TOWAの成長機会がさらに広がっていきます。現状、ハイエンドの領域で80%以上のシェアを確保しているのに対して、ミドルレンジやローエンドの領域におけるニーズにもコスト力で勝負していくことで、全体としてのシェアを一層高めていくことができるものと考えています。

TOWAはこれまでの歴史の中でも3度にわたるモールディング革命を起こしてきたことで、その都度、事業を成長させてきました。第一次は1979年におけるマルチプランジャモールドの開発による業界標準の確立、第二次は1995年のモジュールシステムを採用したベストセラー機の開発、そして第三次は2009年のコンプレッション装置の市場投入です。およそ10数年のサイクルで革命を起こしてきた中で、2025年に向けては生産プロセスに関連した第四次モールディング革命を創出する時期に来ているかと思います。この点、時期を見て具体的な内容をリリースしたいと考えております。

モールディング以外の分野でも事業の柱を育てていく

現状、モールディングを中核に事業の成長を目指しておりますが、そのほかの3つの事業分野でも長期的な展望のもとで新たな挑戦を進めています。特に新事業においては、TSS（トータル・ソリューション・サービス）として、装置リニューアルビジネスを拡大していきたいと考えております。現在は韓国、台湾が中心ですが、中国、東南アジアなどの地域にも専門の人員を配置して本格的に展開していきます。また、ツーリング事業（切削工具）、受託事業の分野においてもTOWAの技術面での強みを活かして事業の拡大を目指します。一方、事業規模こそまだ大きくはないものの、コーティング技術を追求し展開する過程で画期的といえる撥水加工の技術を生み出しています。将来に向けて大きく花開く可能性を秘めており、事業を着実に育てていきます。こうした事業群は2032年における売上高1,000億円超のその先の成長に寄与するものととらえており、いずれもモールディングと同様に技術革命を起こしていくことで事業の柱を次々と立てていく考えです。

そして、事業の拡大を成し遂げていく上ではサステナビリティの取り組みも重視しています。カーボンニュートラルへの貢献をはじめとする環境への取り組みや、人的資本への対応、コーポレート・ガバナンスの強化など、それぞれのテーマに対して時代の先を見すえつつ、何事もいち早く取り組むことを大切に対処していきます。これまでも、これからもTOWAは常に変革を通じて「世界の頂」に挑む企業であり続けます。

ステークホルダーの皆様におかれましては、引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

CHAPTER 02

TOWAグループの価値創造プロセス

さまざまな用途で半導体需要が急増する中、TOWAグループ に対するお客様の期待はますます大きくなっております。サステナビリティの実現などの社会課題解決への貢献を見据え、当社にしかできないビジネスモデルを構築して今後もさらなる成長と企業価値の向上を追求し、唯一無二の企業を目指します。

インプット（経営資本）

財務資本

資産合計	純資産合計
87,861 百万円	58,435 百万円

製造資本

設備投資額	生産拠点
2,004 百万円	国内5箇所 海外6箇所

知的資本

研究開発費	所有特許権件数
963 百万円	国内455件 海外918件

人的資本

連結従業員数
1,985人

社会・関係資本

グローバルネットワーク（連結子会社数）
18社
（国内3社、海外15社）

自然資本

総エネルギー使用量（電力）	総水使用量
43,048MWh	97.00千m³

2023年度通期ないしは2023年度末時点の数値

ビジネスモデル

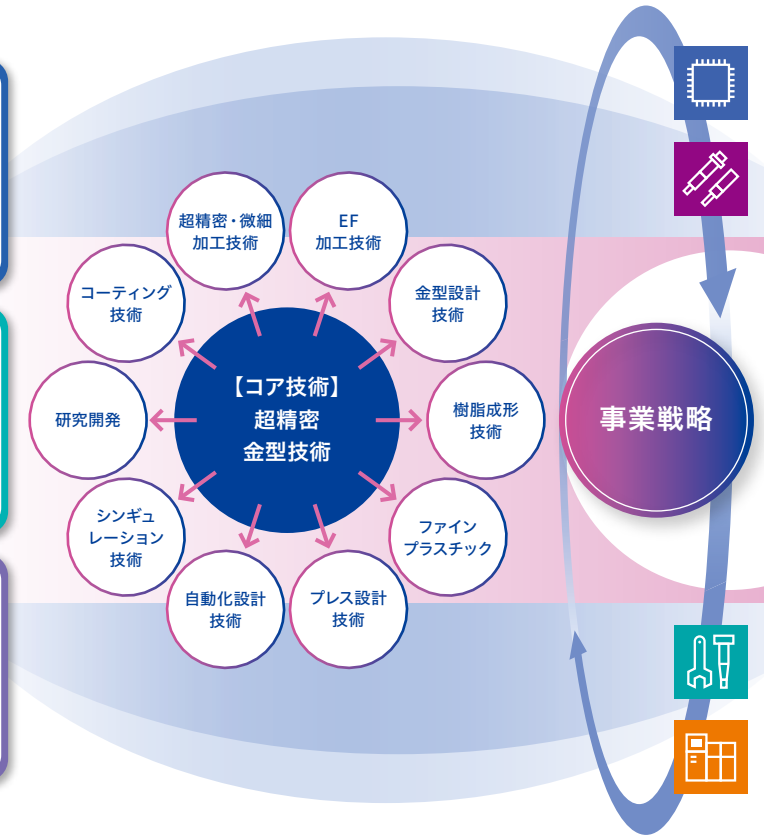
事業活動

TOWAグループの強み

テクノロジー
超精密金型をTOWAの原点とし、半導体製造の後工程における革命的なソリューションを発信。

サポート＆サービス
お客様の生産環境を人とIoTで支える総合的なサポートサービスを提供。

グローバル展開
生産・販売・開発拠点を設立し、現地のニーズに対応。



持続的な価値創造経営戦略

経営理念	産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、ク 「新製品・新商品」の創成に向けて、果敢 全力を傾注して成果を生み出し、もって産業の発
TOWAビジョン2032 （長期経営計画）	テーマ 変革で世界の 他社の追随を許さない唯一
中期経営計画 （2022/4 ～ 2025/3）	テーマ TOWAが創り出すプロセ 製品を納めてから始まるビジネス

アウトプット・アウトカム

半導体事業

化成品事業

新事業

レーザ事業

TOWAグループの
マテリアリティ（重要課題）

サステナビリティ
戦略（方針）

- 社会への貢献を通じたTOWAの価値創出
- 環境負荷低減への貢献
- 健康経営と労働安全衛生の推進
- 人財育成と多様な人財の活躍促進
- ガバナンス体制の更なる強化

ォーター・リードに徹した
なる挑戦のもと、
展に多大の貢献をはたす。

頂へ
無二の企業に

スイノベーション
の確立を目指す

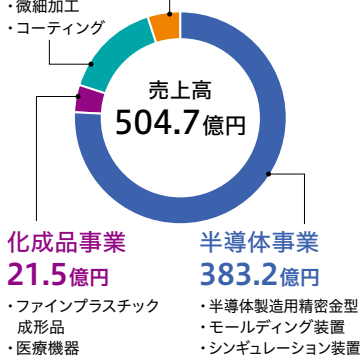
経済価値

第一次中期経営計画
世界の頂への基盤強化

2022/4 ～ 2025/3

売上高	600億円
営業利益	126億円
営業利益率	21.0%

2023年度実績



超硬エンドミルシリーズ

ウェハマーカ

ファインプラスチック成形品

コンプレッションモールディング装置

長期経営計画
TOWAビジョン2032

達成目標

売上1,000億円と高利益率の達成

2032年3月期目標数値

- 売上高　1,000億円
- 営業利益　250億円
- 営業利益率　25.0%

ありたい姿

1. パッケージングプロセス提案により顧客価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニー
2. TOWAの技術でサステナブルな社会を実現する会社
3. 積極的な情報発信で知名度の高い会社
4. 企業文化の伝承と多様な価値観を尊重する笑顔で働ける会社

TOWAグループの培った強み

TOWAには、ものづくりにかける思いをひたむきに研究・開発に注いだ先人たちが、長年かけて築いてきた技術基盤があります。この基盤を最大の強みとして、アフターサポートをはじめとするトータルソリューションサービスを拡充。開発・生産・販売拠点を世界に拡大し、お客様のすぐそばで、開発から製造、供給までご要望に迅速かつ適切にお応えしています。

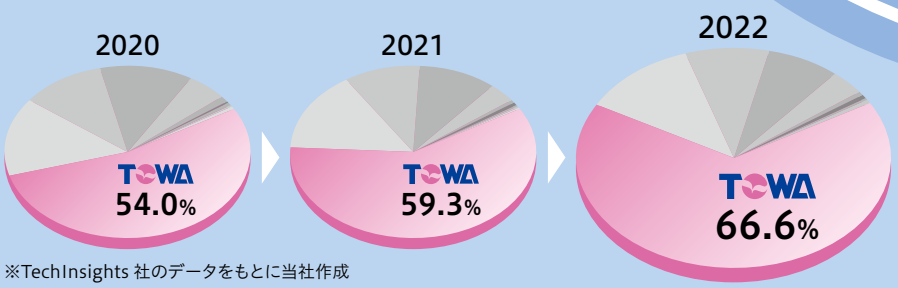
- コア・コンピタンス ～ 超精密金型を創出してきた金型関連技術
- 市場ニーズを先取りするソリューション提案型の開発

テクノロジー

TOWAの成長

数字で見る TOWAの現在地

半導体モールディング
装置世界シェアの推移



※TechInsights 社のデータをもとに当社作成

サポート&サービス

- Total Solution Service（TSS）
  - サポートサービス
  - 生産性向上サービス
  - 部品供給サービス
  - 付加価値提案
  - サポートシステム TEN-System
- トレーニングセンター
- ラボラトリ

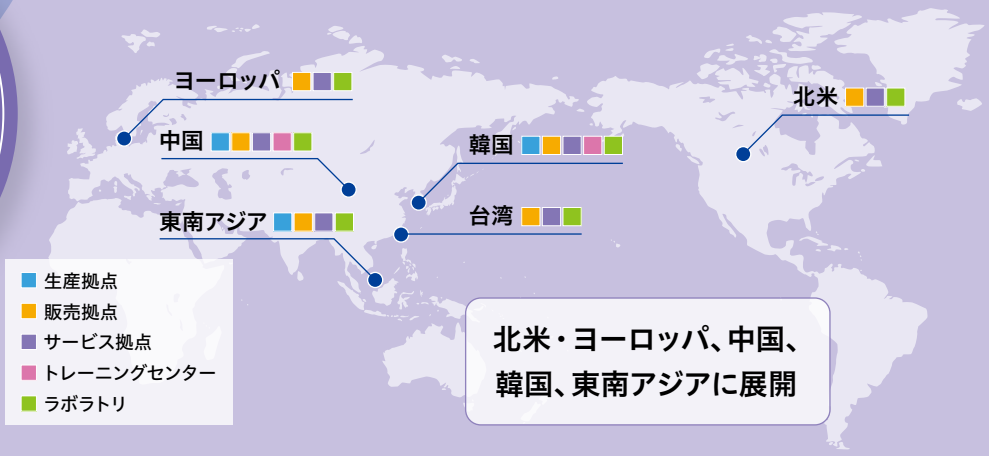
サービスエンジニアによるサポートサービス

サポートサービスを支えるインターネット

を支える三つの強み

グローバル展開

- 主要な半導体生産地域に販売拠点および生産拠点を展開
- 市場変化に柔軟に対応できるサービス体制を構築



北米・ヨーロッパ、中国、韓国、東南アジアに展開

TOWAグループの技術と製品

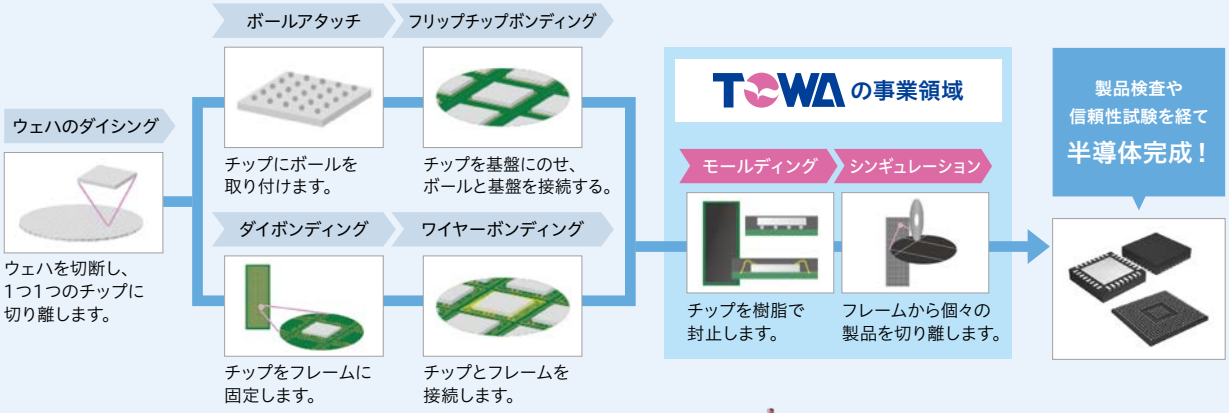
TOWAグループにおける最大の強みは技術です。特に半導体製造の後工程では最先端技術を世界に発信し続けてきました。原点は、超精密金型のモジュールシステムの開発であり、そこで培われた超精密微細加工技術が、化成品事業や新事業への足がかりとなりました。いまだ他社の追随を許さないコンプレッションモールドはじめ、多彩な技術が世界のテクノロジーの発展に役立っています。

半導体

半導体製造における後工程の革命的ソリューション

前工程と後工程について

半導体の製造には前工程と後工程があり、当社は後工程で使われる装置を製造するメーカーです。後工程には、半導体チップを基板の上に並べる、金線をつなぐ、樹脂で覆いチップを保護する、カットして個片化する、動作をテストするといった工程があります。チップを樹脂で覆う(=封止する)工程をモールディング、個片にカットする工程をシンギュレーションといい、当社ではこれらの装置の性能を徹底的に追求してきました。

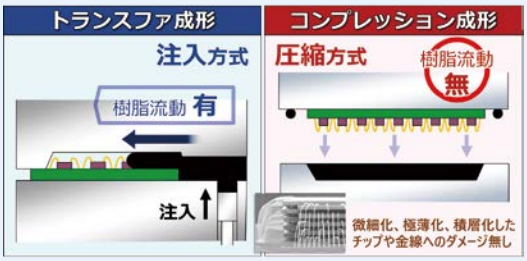


モールディングで圧倒的地位を築いたコンプレッション装置

モールディングには従来、閉じた金型の窪みに樹脂を注入するトランスファ成形という方法が使われていましたが、注入時の樹脂の流動で金線が歪み、デリケートなチップにダメージを与えるという問題がありました。それを解決したのが独自のコンプレッション装置です。樹脂の中に浸すことで流動の影響を取り除いたコンプレッション(圧縮)成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能となりました。

コンプレッションモールドは、2.5D、3Dパッケージなどの次世代パッケージに最適であり、自動運転、5G、AI、IoTなどの次世代技術で加速的に拡大する半導体需要を見込んだ成長が期待できるため、当社の技術的な強みとなっています。

Model **PMC2030-D**
特許や技術的難度から、2009年の発売以来他社の追随がない。

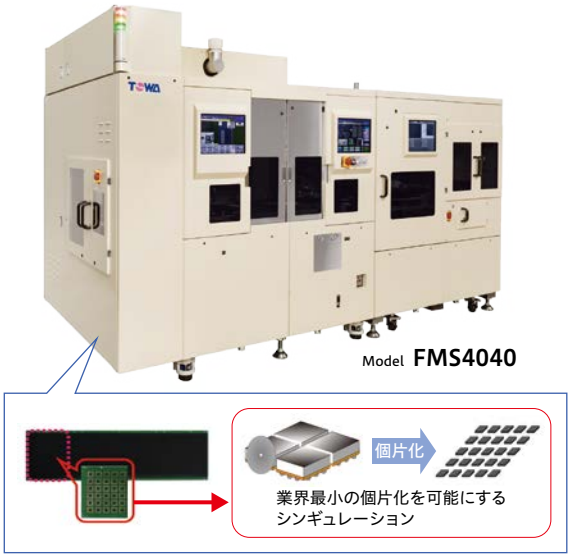


トランスファ成形→コンプレッション成形によるパッケージソリューション。メモリなどのハイエンド製品にコンプレッション成形は欠かせなくなっている。

高品質化と生産性向上に貢献するシンギュレーション装置

モールディング工程で封止されたパネル状の半導体を一つひとつの個片に切り分けるのがシンギュレーション装置です。当社の装置は1mm×1mmの個片化が可能で、業界最小を誇ります。

当社グループで開発製造を行っている切断用ブレードと合わせたソリューション提案も強みです。省人化と生産性および環境特性を向上させた最新機種「FMS4040」や既存製品の拡販、さらにはレーザ事業との開発連携強化によるコラボ製品の市場投入も進めています。



化成品

ナノテクを生かしたプラスチックの成形加工で医療に貢献

クリーンルーム

医療用ファインプラスチック成形

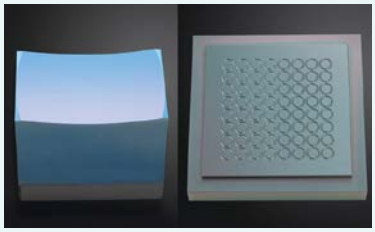
化成品事業は医療機器が中心となっており、医療注射器、点滴用部品といった医療用ファインプラスチック成形品などの受託生産を行っています。独自の超精密・微細加工技術で製作された金型による高精度な量産成形と、クリーンルーム設備での「射出成形～組立」をコア技術とした検査・出荷までワンストップでの生産が特徴です。開発品や小ロットから量産に至る成形まで、お客様のニーズにお応えしています。環境に配慮したバイオマスプラスチック・生分解プラスチックへの取り組みも行っています。

新事業

TOWAのコア技術を応用した新規事業の展開

金型の超精密加工技術を支える自社開発のエンドミル(工具)の販売、超精密加工技術やコーティング技術を応用した受託加工ビジネス、当社半導体製造装置のアフターサービスや改造・修理、中古機の販売までトータルで提案するTSS事業を展開しています。

CBNエンドミルシリーズ


レンズ成形型(左)とゴム成形型(右)

TOWAグループのマテリアリティ

マテリアリティ（重要課題）の特定

TOWAグループのマテリアリティ（重要課題）を特定しております。このマテリアリティは、長期ビジョン「TOWAビジョン2032」で明確にした10年後のありたい姿に向けた課題です。社会への価値提供を通じて社会の持続可能性の向上を図ると同時に、企業の長期的・持続的な「稼ぐ力」の向上と更なる価値創出へとつなげてまいります。

特定プロセス

STEP1 課題抽出

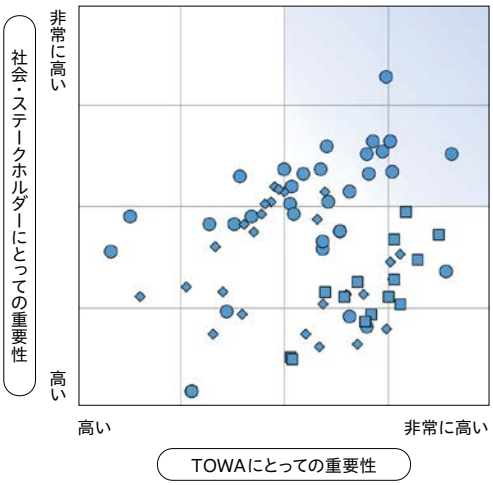
- GRIスタンダード、国連グローバル・コンパクトなどのESGやCSRのガイドラインや、ESG評価機関が重視する評価項目などを参考に網羅的に社会課題を抽出
- 社内からは長期ビジョンや中期経営計画検討における資料、当社グループや各部署で実施したリスク検討資料などを参考に抽出

STEP2 分 析

- 抽出した課題を整理し、社内各部署を対象としたアンケートを実施
- 社会やステークホルダーおよび当社グループからの視点で重要性を分析し、マテリアリティマトリックスを検討・活用するなどして社内にて協議を重ね、マテリアリティ案を作成

STEP3 特 定

- 集約、最終化を実施
- 経営層との協議、取締役会における審議承認を経て決定



縦軸を社会やステークホルダーにとっての重要性、横軸をTOWAの重要性、としたグラフを活用して重要性の高い項目を分析。

「TOWAビジョン2032」の「ありたい姿」とのつながり

これらのマテリアリティは、抽出した課題を分析し特定する過程において、10年後のありたい姿・世界の頂に向けて取り組むべき課題、取り組み解決することで企業価値が高まる課題であることを考慮して集約し、最終化を行いました。

TOWAグループのマテリアリティ

マテリアリティ	取り組みの内容	関連するSDGs
社会への貢献を通じたTOWAの価値創出	●クォーターリードに徹した「新製品・新商品・サービス」の提供による顧客の信頼と満足の向上に取り組み、価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニーを目指します。 ●TOWAのコア・コンピタンスを基礎とした技術活用や社会課題を見据えた取り組みにより、サステナブルな社会実現への貢献を図ります。 ●取り組みは、積極的な情報発信により知名度の向上につなげます。	9 産業と技術革新の基盤をつくろう 12 つくる責任 つかう責任 13 気候変動に具体的な対策を 17 パートナーシップで目標を達成しよう
環境負荷低減への貢献	●自社事業におけるCO_2排出量の削減に取り組み、再生可能エネルギーの導入を進め、グループ全体でカーボンニュートラルを目指します。 ●自社製品については、環境型開発を推進し、環境配慮型製品やサービスの提供を進めて、お客様の脱炭素・環境対策への貢献を図ります。また、改造ビジネス・中古機販売、TSS（Total Solution Service）を通してサーキュラーエコノミー（廃棄物の発生を抑止し製品を高い価値のまま循環させる経済活動）を推進します。 ●環境マネジメントシステムによる環境保全の取り組みを推進し、廃棄物削減、環境負荷化学物質の厳格な管理を実践します。	7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに 9 産業と技術革新の基盤をつくろう 12 つくる責任 つかう責任 13 気候変動に具体的な対策を
健康経営と労働安全衛生の推進	●『健（すこやか）漲（みなぎ）りて業（なりわい）壮（さかん）なり』を実践します。健康維持・増進、労働環境・安全衛生の向上、従業員エンゲージメントの強化を図り、社員が喜びとやりがいを抱いて仕事に取り組める環境を整えていきます。 ●DXによる業務効率化により働き方改革を推進します。	3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 8 働きがいも経済成長も
人財育成と多様な人財の活躍促進	●多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードするグローバル人財の育成、変化する環境（リスク）に対応できる人財の育成を図ります。 ●ダイバーシティを尊重し、多様な人財が活躍できる環境を整え促進していきます。 ●創業以来培ってきたTOWAのコア・コンピタンス技術や企業文化を伝承していきます。	4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう 8 働きがいも経済成長も 10 人や国の不平等をなくそう
ガバナンス体制の更なる強化	●コーポレートガバナンス、コンプライアンスの取り組みを推進し、ガバナンス体制の強化を図ります。 ・リスクマネジメントの強化　・BCP体制の強化 ・知的財産戦略の強化　・情報セキュリティの強化 ・個人情報保護の取り組み	5 ジェンダー平等を実現しよう 8 働きがいも経済成長も 10 人や国の不平等をなくそう 16 平和と公正をすべての人に

CHAPTER 03

長期ビジョン「TOWAビジョン2032」

2022年3月、世界において他社の追随を許さない唯一無二の企業を目指し、パラダイムシフトを図りこれまでと全く違った一段高いステージへ上がるため、10年後に向けた新たなるチャレンジ、長期ビジョン「TOWAビジョン2032」を策定しました。

長期ビジョン

「TOWAビジョン2032」

テーマ「変革で世界の頂へ」

世界の頂とは、文字通り世界のトップであり、他社の追随を許さない唯一無二の企業になることです。そのために段階的に達成すべき目標を設定するとともに、今後TOWAがどのような企業であるべきかを改めて問い直し、10年後のTOWAの「ありたい姿」を4つの目指すべきポイントに整理して定めました。

第一次中期経営計画	第二次中期経営計画	第三次中期経営計画
「世界の頂」への基盤強化	新たな課題への挑戦と飛躍	売上1,000億円と高利益率の達成
2022/4 ～ 2025/3	2025/4 ～ 2028/3	2028/4 ～ 2032/3
2025年3月期目標数値	2028年3月期目標数値	2032年3月期目標数値
売上高 600億円	売上高 760億円	売上高 1,000億円
営業利益 126億円	営業利益 167億円	営業利益 250億円
営業利益率 21.0%	営業利益率 22.0%	営業利益率 25.0%

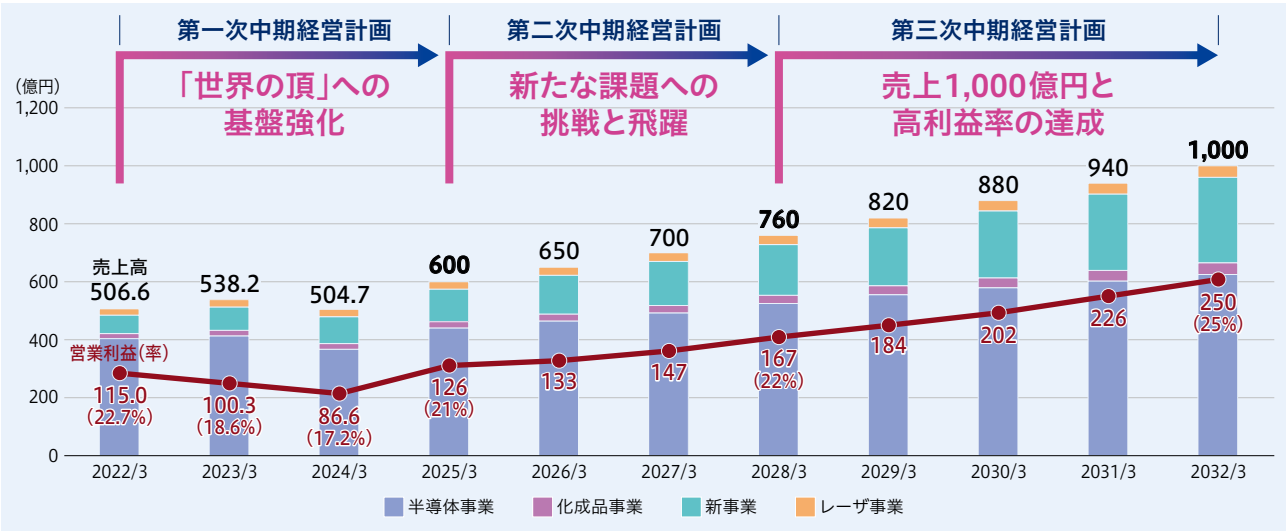
前長期ビジョン（2014年4月～2022年3月）では、2014年度に売上高171億円からスタートし、10年後の売上高500億円、営業利益80億円、営業利益率16%という大きな目標を掲げました。達成に向け、市場動向を先読みしつつ積極的な設備投資を行った結果、2022年3月期にその目標を2年前倒しで実現しました。

「TOWAビジョン2032」では、「変革で世界の頂へ」をテーマに、2032年3月期に売上高1,000億円と、営業利益250億円、営業利益率25.0%の高収益率の達成を目指します。

TOWAビジョン2032の業績目標において、2032年3月期までの10年間を三つのフェーズに分け、それぞれ第一次、第二次、第三次中期経営計画として取り組んでまいります。

最初の3年間は、“「世界の頂」への基盤強化”を行う期間と位置付け、新技術の開発や生産設備への投資に加えて、TOWAの技術を次世代へ伝承するための人財育成や、事業規模拡大に向けた人財の獲得を積極的に行います。効率化を図るためのDX投資なども行うため、第一次中計では一時的に利益率が低下しますが、第二次以降はこれらの投資効果により、営業利益率は改善する計画です。

変革で世界の頂へ



10年後(2032年)にTOWAがありたい姿

今後TOWAがどのような企業であるべきかを改めて問い直し、10年後のTOWAのありたい姿を次のように定めました。

1 パッケージングプロセス提案により顧客価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニー	TOWAの誇るパッケージングプロセスに係る技術、ノウハウを提供することにより、お客様が得られる価値を創出します。
2 TOWAの技術でサステナブルな社会を実現する会社	TOWAの技術を様々な分野に活かし、持続可能な社会の実現に貢献します。
3 積極的な情報発信で知名度の高い会社	人財確保やBtoCを視野に入れた新たな事業展開においては、広く社会全般における知名度向上が必要と考え、積極的なPRに努めていきます。
4 企業文化の伝承と多様な価値観を尊重する笑顔で働ける会社	培ってきたDNAを10年後も伝承するとともに、時代の変化に応じた多様な価値観を認め、柔軟な対応で社員を大切にする会社を目指します。

TOWAグループのマテリアリティ
社会への貢献を通じたTOWAの価値創出
環境負荷低減への貢献
健康経営と労働安全衛生の推進
人財育成と多様な人財の活躍促進
ガバナンス体制の更なる強化

また、このありたい姿に向けて取り組むべき課題、取り組み解決することで企業価値が高まる課題として、TOWAグループのマテリアリティを特定しております。持続的な「稼ぐ力」の向上と更なる価値創出へとつなげ、世界の頂を目指してまいります。

第一次中期経営計画の進捗（2022/4～2025/3）

TOWAは、「装置・金型」を納めてお客様から代金をいただくまでで完結していたこれまでのビジネスから変革を図り、「製品を納めてから始まるビジネス」の確立を目指します。具体的には、TOWAが半導体パッケージングプロセスにイノベーションをもたらし、より効率的な生産プロセスを提供・ギャランティーし、そこから対価を獲得するビジネスの創出を目指します。

「TOWAが創り出すプロセスイノベーション」をテーマに、世界の頂への基盤強化を図ります。

第一次中期経営計画は、2022年4月から2025年3月までの3カ年計画です。3年後、売上高600億円、営業利益126億円を目指します。この第一次中期経営計画の2年目にあたる2023年度は、長期ビジョンを達成するための基盤強化の期間として、新技術の開発や設備投資、人財育成などを積極的に推進しました。

第一次の数値目標～長期ビジョン達成のための基盤強化

第一次中期経営計画
世界の頂への基盤強化

2022/4 ～ 2025/3

2025年3月期目標数値

売上高	600億円
営業利益	126億円
営業利益率	21.0%

内訳

（単位：億円）

	2023/3期 実績	2024/3期 実績	2025/3期 予想
売上高	538.2	504.7	600.0
半導体事業	412.6	383.2	443.0
化成品事業	19.5	21.5	22.0
新事業	80.1	75.8	104.0
レーザ事業	25.8	24.2	31.0

第一次中期経営計画・5つの基本方針

1 パラダイムシフトにより保有する技術・品質・プロセス（ノウハウ）の付加価値をビジネス化し収益力を高める	発想を転換し、「モノを売る」にとどまらず、TOWAの付加価値を売るビジネスを展開します。
2 DXの活用によりスループットを最大化し市場競争力と財務基盤の強化を図る	売上の増大、在庫低減と売掛金回収の早期化、リードタイムや開発期間の短縮、材料費・外注費・経費の低減などに徹底して取り組みます。
3 コア技術を根幹に新たな事業と収益の拡大を図る	引き続き、超精密・微細加工、コーティング技術など、TOWAが保有するコア技術を活用します。
4 多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードする人財の育成を図る	前10年ビジョン達成の大きな要因となった「人」の育成について、今後さらに、1,000億円企業にふさわしい挑戦思考を持った人財を生み出していきます。
5 SDGs・ESGへの積極的取組みにより企業価値の向上を図る	サステナビリティ基本方針に基づき、地球環境への影響や、地域・国際社会とのつながり、あらゆるステークホルダーの安心と健康に配慮した活動を行います。

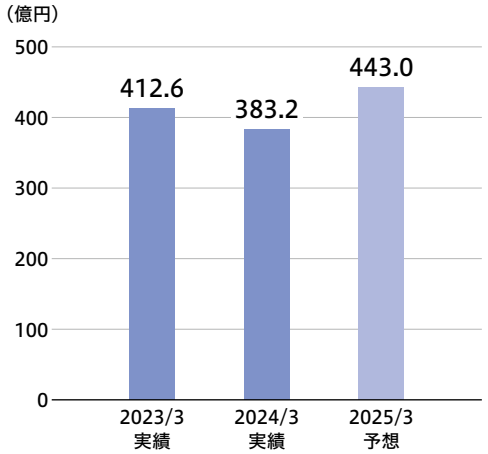
事業戦略

半導体事業

コンプレッション技術などのTOWA独自の技術や、モールディング装置のリーディングカンパニーとして培った知識や経験を生かし、それらの付加価値をビジネスに展開してまいります。

戦略 1	付加価値を生かしたプロセスビジネスの展開により、半導体事業の収益力を強化します。
戦略 2	リードタイム短縮および在庫削減を目的とするMIP（Minimal Inventory & Period）により、生産体制・財務基盤の強化を図ります。
戦略 3	開発リソースへの積極的な資源投入により、顧客ニーズの先取りやSDGs・ESG投資に適った製品開発を、スピード感を持って実行いたします。
戦略 4	シンギュレーションとブレードの連携によって市場を獲得します。

半導体事業の売上目標

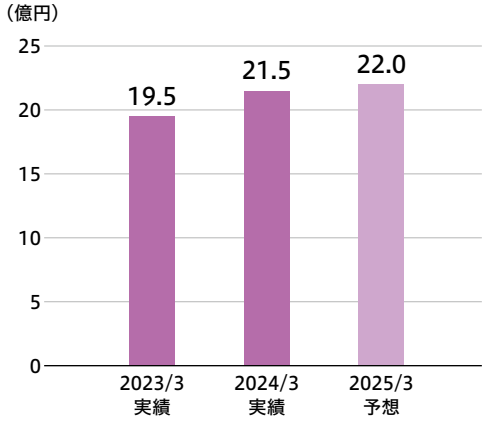


化成品事業

培ったコア技術をもとにブランドの付加価値を高め、医療機器のライセンスを生かして商品の多様化を図ります。当事業は医療現場に深く関わっており、品質・コスト・納期が高い水準で求められるため、これまで以上に品質・コスト・納期を追求し、安定した収益体質を構築いたします。

戦略 1	化成品事業で培ったコア技術をもとにTOWAブランドの付加価値を高め事業規模を拡大します。
戦略 2	品質・コスト・納期を更に追求し安定した収益体質を構築します。
戦略 3	医療機器のライセンスを生かし、商品の多様化を図ります。

化成品事業の売上目標



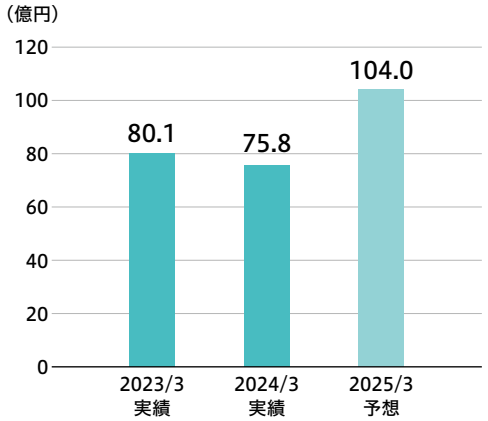
事業戦略

新事業

超精密・微細加工やコーティング技術などのコア技術を応用しTOWAオリジナル商品の創出を目指します。同時にTSS(トータル・ソリューション・サービス)事業の拡大も図ります。またグローバル展開する生産拠点を活用し、技術面だけでなくコスト面でも競争力を高めてまいります。

戦略 1	コア技術の応用展開により新たな柱となる事業を独立させ、ポートフォリオの変革を図ります。
戦略 2	TOWAオリジナル商品の創出により新たな事業化を実現します。
戦略 3	TSS事業を通じてお客様の安定稼働に貢献し、長期的関係を確保します。
戦略 4	グローバル生産拠点を活用した原価低減により競争力強化とシェア拡大を図ります。

新事業の売上目標



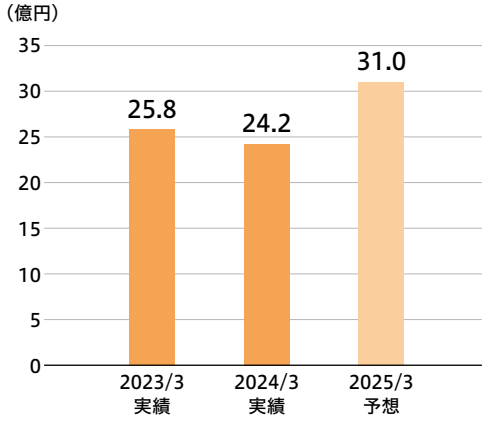
レーザ事業

メーカーとして、これまでにない製品やこれまでよりも良い製品を生み出すことは当然ですが、それが価値(利益)を獲得できなければ企業活動としての意味は大きく下がります。当社は、レーザ事業の技術やノウハウをもとにアプリケーションを強化し新商品を創出するとともに、「価値創造」と「価値獲得」を図ります。

さらに、顧客のプロセスを徹底追及し、顧客が求める価値に対する理解を深め、課題解決型ビジネスができる企業を目指します。

戦略 1	アプリケーション強化により新商品を創出し、「価値創造」と「価値獲得」を図ります。
戦略 2	TOWAグループの生産・販売拠点を活用し生産能力アップ・原価低減と販売体制・サービスの強化を図ります。
戦略 3	顧客プロセスを徹底追求し、課題解決型ビジネスができる企業へ成長していきます。

レーザ事業の売上目標



機能別戦略

販売戦略

1. プロセスサポートを強化し当社技術でしか生産できないビジネスモデルの構築による販売拡大と収益力の向上
2. 当社独自技術のコンプレッション装置による活用範囲の拡大
3. グローバル販売・管理体制・サービス体制の強化による顧客満足の向上

開発戦略

1. パラダイムシフトによりお客様のニーズに沿った新製品を開発する
2. モールドプロセス開発と次世代モールディング革命によりディファクトスタンダードを確立
3. SDGs・ESGを意識した環境型開発の推進

生産戦略

1. グローバル生産・購買体制の最適化による原価低減およびリードタイムの短縮
2. 生産技術の向上により品質の信頼性を高める
3. DXを活用した高付加価値の製品生産に取組む
4. 変化する環境（リスク）に対応できる人財の育成と事業構造の構築

人財・組織戦略

1. プロセス開発からソリューション提案まで行うTOWA拠点のグローバル展開
2. 次世代をリードするグローバル人財の育成
3. DXによる業務効率化により働き方改革を推進
4. TOWA技術の伝承のためのTOWAアカデミーの創設

特集1 戦略的技術

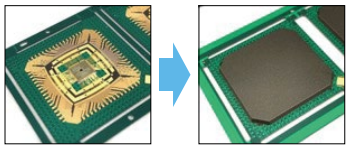
現代社会を支え、未来の高度なデジタル化社会実現に貢献

最先端半導体をはじめとするさまざまな分野の半導体製造に必要とされる当社モールディング技術のご紹介

近年、AIをはじめ革新的な技術による製品やサービスが次々と生まれ、社会実装が本格的に進んでおり、社会のデジタル化が進む中で半導体の需要はますます増大し高度化が進展しています。TOWAは、勃興期の半導体産業と共に歩み、1979年の創業から画期的な技術革新を通して成長を遂げてきました。最先端半導体をはじめとするさまざまな分野の半導体製造に必要とされる当社のモールディング技術について紹介します。

繊細な半導体チップを守るモールディング（樹脂封止）技術

半導体チップは極めて微細かつ繊細なため、動作不良や故障を引き起こさないよう、ほこりや湿気、物理的衝撃などの外部要因から保護する必要があります。製品によっては発生する熱の冷却性や電子基板への実装性に対する考慮も必要です。現在、半導体チップの封止は、コストや製品の取り扱い性に優れた金型を用いた熱硬化性樹脂によるモールディングが主流となっています。当社はモールディング装置のリーディングカンパニーとして、創業当初からお客様に数々の斬新なその製造技術を提案してきました。これまでに3度の大きな技術革新を成し遂げており、それらをモールディング革命と呼んでいます。



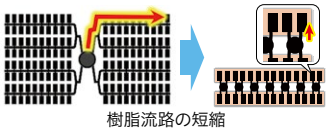
モールディング革命・・・技術革新で半導体業界の発展に貢献

第1次モールディング革命

マルチプランジャの開発
～業界標準の確立～

マルチプランジャモールドにより高品質化と廃棄樹脂低減を実現

樹脂サイズ：	手のひら大	指先大
樹脂流路：	長い	短い（高品質）
廃棄樹脂：	多い	少ない



樹脂流路の短縮

コンベンショナルモールド

マルチプランジャモールド全自動機

第2次モールディング革命

モジュールシステムの開発
～Yシリーズの爆発的ヒット～

モジュールシステムにより プレスの増減が可能に！

生産量、品種にフレキシブルに対応

4モジュール連結

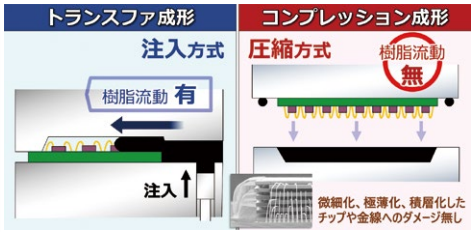
2モジュール連結

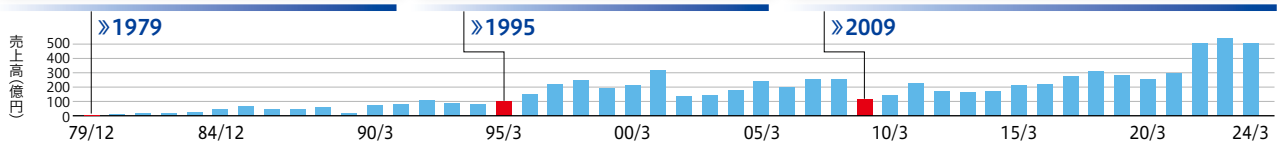
第3次モールディング革命

コンプレッション装置の市場投入
～新たな業界標準の確立～

最先端製品の高品質な封止と 大幅なコスト削減が可能に！

- メモリや5G向けなど最先端製品に最適
- 樹脂使用効率100%
- パネルサイズ、ウェハサイズに対応
- リリース以来、他社の追随なし

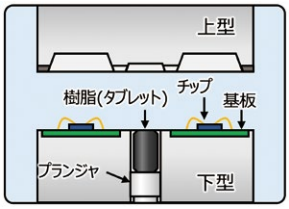




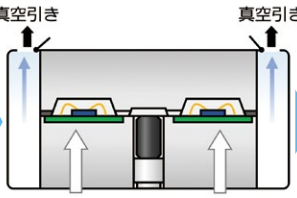
トランスファ成形とコンプレッション成形

当社では、製品の種類や形態の特徴に応じて最適な装置やプロセスの提案を行っています。トランスファ成形とコンプレッション成形の基本的な成形プロセスをそれぞれの特徴とともに紹介します。

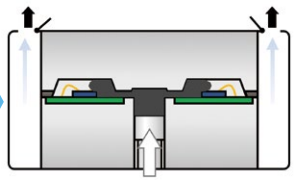
トランスファ成形



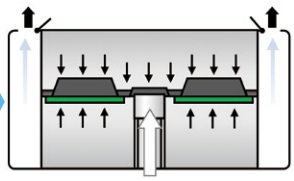
チップが搭載された基板と樹脂(タブレット)をセットします。



型締め(クランプ)をします。高品質が要求される場合は真空引きを行います。真空引きにより未充填や気泡を抑制できます。

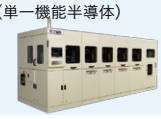


プランジャで樹脂(タブレット)を押し上げ、高温の金型により溶融した樹脂を型内に注入していきます。

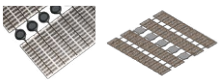


樹脂は熱硬化性樹脂です。硬化するまで加圧を保持します。樹脂が硬化したら金型を開いて成形品を取り出します。

Model
YPM1180
大判ディスクリート
(単一機能半導体)



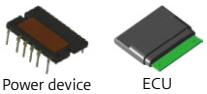
Metal Frame



Super matrix　4Frame molding

Model
YPM1120
車載・パワーデバイス
可動ピン対応

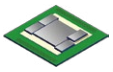
Metal Frame　Substrate



Power device (IPM)　ECU (built-in substrate)

Model
YPM1250-EPQ
2.5D/3DIC/
チップレット製品向け

Substrate

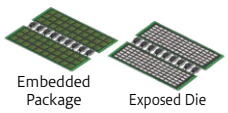


R.F.C.P.®と大容量フローキャビティによる大型チップのMUF成形

CPU/GPGPU (Large panel substrate)

Model
YPM1080-EP
チップ露出製品

Substrate



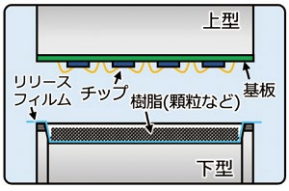
Embedded Package　Exposed Die

生産性、品質、成形機能を誇る トランスファ装置

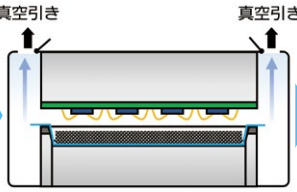
一括封止でない個別のパッケージを中心に、培われてきた技術にて多彩な用途、生産にマッチ。
高度な技術を要するパッケージにも高い品質で対応可能。

- 両面成形品
- ヒートシンクなどの露出部対応
- 厚みや体積のあるパッケージ
- 2.5D、チップレットなど先端パッケージにも好適

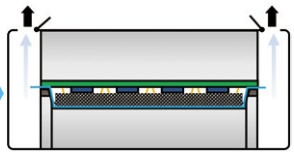
コンプレッション成形



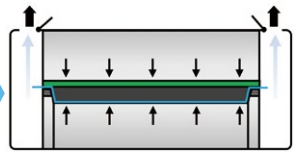
基板と樹脂をセットします。
基板を上型にセットするキャビティダウン構造はTOWA独自の技術です。



真空引きをします。樹脂流動が無いコンプレッション成形には高度な真空技術が欠かせません。



基板をクランプし、チップを樹脂に浸し圧縮していきます。樹脂流動が無いため、場所によるフィラー(樹脂中の充填材)のムラや成形状況の差は生じません。



保圧します。エアやアウトガスが残留しにくいためトランスファ成形より低圧での成形が可能です。樹脂が硬化したら金型を開いて成形品を取り出します。

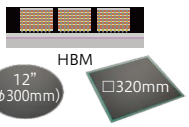
Model
CPM1180
業界ニーズに先行した
超大判成形Full-Auto機

Large Panel

パネル最大サイズ:660×620mm

Model
CPM1080-HP
HBM/2.5D/3D/Chiplet,
FOWLP/PLPなどの
先端パッケージ

Wafer, Panel



Model
PMC2030
高充填&高平坦度要求製品
(顆粒/液状樹脂対応)

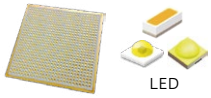
Substrate

DRAM(PoP)　FC-SiP(MUF)

Memory、RF Moduleにはコンプレッション成形技術が不可欠

Model
LCM series
LEDパッケージの
量産に最適

Substrate, Panel



LED

最先端の市場ニーズに応える コンプレッション装置

一括成形を行うパッケージ、ウェハレベル品に好適。

- 樹脂効率100%で環境に貢献
- 樹脂流動が無く均一、高品質
- 狭ギャップへの樹脂充填が可能(最先端メモリなど)
- 低圧成形可能(RFモジュールやMEMSデバイスなどに必須)
- 600mm角超の超大判成形
- 照明用LEDにも対応

特集2 戦略的技術

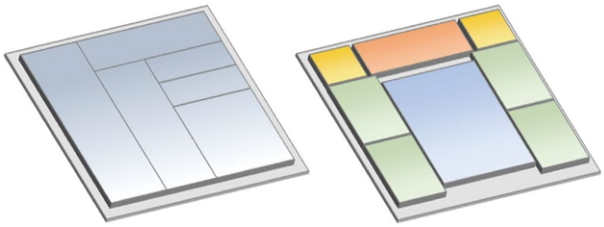
現代社会を支え、未来の高度なデジタル化社会実現に貢献

微細化の制約を打ち破る“チップレット”技術や生成AI向け半導体に必須な超高速メモリ“HBM”に貢献

半導体は、微細化や集積化により高性能化することで情報化社会の発展を支えてきました。これからも、AIの普及や社会の高度なデジタル化に向け、半導体にはますます性能の向上が求められます。これまで半導体の性能向上は、前工程における回路の微細化・集積化により実現されてきました。しかしながら、回路の配線幅の微細化には物理的な限界があり、その製造プロセスにおいては設備投資の巨額化に直面しています。また1つの半導体チップで高性能・高機能化を実現しようとするとチップサイズが拡大することになり、製造歩留まり低下や、円いウェハからの取れ数減少によるコストアップが大きな問題になってきます。

チップレット技術　～後工程による微細化制約の打破～

近年、後工程の技術にてこれらの課題を打破しようとする取り組みが注目されています。その1つにチップレット技術があります。別々の機能を持つ半導体チップ(チップレット)を複数水平に並べたり積層して1つのパッケージに収める後工程の実装技術です。チップレット技術では、1つの大きなチップに極めて微細な回路を作製して高性能な半導体製品を製造するのではなく、別々の機能を持つ小さな半導体チップ(チップレット)をそれぞれ合理的なプロセスで製造し、あらためてそれらを大きな基板上に水平に並べたり積層して組み合わせ、求められる高性能な半導体製品に仕上げます。異種チップ集積技術(ヘテロジニアスインテグレーション)とも呼ばれます。半導体チップの面積は大きくなるほど不良が発生する確率が高くなりますが、小さなチップレットにすることで製造歩留まりが向上し、またチップごとに最適なプロセスで製造できるため、大きく製造コストを低減することが可能になります。



半導体チップ全体を超微細プロセスで製造

それぞれ合理的なプロセスで製造したチップレットを1つのパッケージに集積

一方、このチップレット技術により製造される半導体製品は、高品質が要求されつつサイズが大きくなることから、それに伴う新たな課題もあります。当社は樹脂封止においてこの課題に対するソリューションを提案しています。

“レジンフローコントロール方式”で生成AI向けチップレット製品に対応

生成AI向け、高機能AIパッケージ(チップレット製品)に対応したトランスファ成形装置

樹脂封止を行う際の課題としては、大きな基板で問題となりやすい反りや、製品厚みの制御、大容量の樹脂を欠陥なく均一に充填することなどが挙げられ、極めて高度な技術が必要となります。

2023年9月にリリースした当社のトランスファ成形装置YPM1250-EPQでは、樹脂の流れを高い精度でコントロールする機構として開発した“レジンフローコントロール方式”をはじめとするさまざまな当社技術によりこれらの課題を克服し、従来の技術では難易度が高い大型パッケージに対しても高品質な封止成形を実現しました。また、構成されるチップレットによっては多く熱を発生するものもあり、放熱対策として必要なチップ面の露出成形にも対応しています。

最先端半導体プロセスに貢献する当社製品

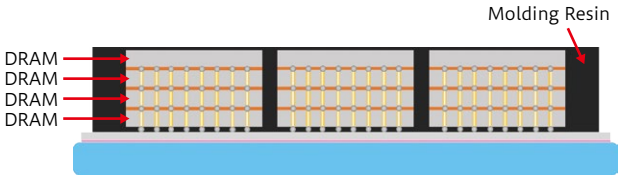
生成AI向け半導体をはじめとした最先端半導体には、CPUやGPUなどの演算用のチップと、超高速メモリHBM（High Bandwidth Memory（広帯域メモリ）の略で高速なDRAMの規格）などを1つの基板（インターポーザ）上に水平方向に並べて配置する2.5D実装と呼ばれる方式が取られるものが多くなっています。ここで使用される超高速メモリHBMは、まず専用の製造工程で生産され、チップは樹脂封止されたのちに、他の半導体チップと共に基板上に実装されます。樹脂封止においては、半導体製品の使用時に発熱などで不具合が生じる恐れがあるため、狭い隙間であっても気泡なく完全に樹脂を充填させる必要があります。その樹脂封止工程に当社のコンプレッション成形装置が不可欠となっています。

最先端半導体の製造工程においては、コンプレッション成形装置だけでなく、トランスファ成形装置やシンギュレーション装置によるソリューションを提供しており、高品質化、高性能化、生産性向上に貢献しています。

HBM、2.5D実装などの最先端半導体プロセスにおける当社製品の役割

最先端半導体には様々な製造プロセスや工程があります。当社製品の貢献事例を紹介します。

超高速メモリHBMの樹脂封止



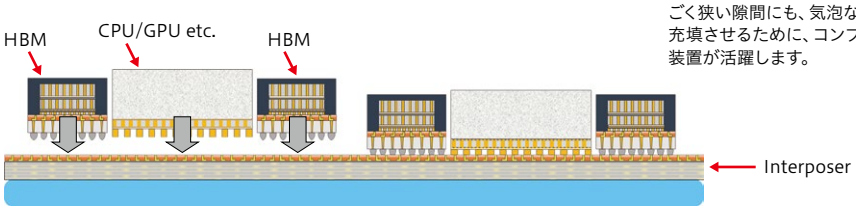
HBMの断面イメージ（2.5D実装前）

Model CPM1080

最先端半導体の樹脂封止に最適なコンプレッション成形装置

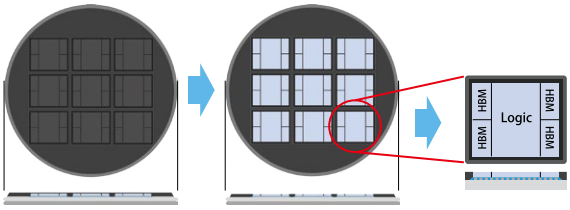
ごく狭い隙間にも、気泡なく完全に樹脂を充填させるために、コンプレッション成形装置が活躍します。

2.5D実装（CoW：Chip on Wafer）と樹脂封止



インターポーザ上に異種チップが集積された2.5D実装（CoW）のイメージ

個片化



封止工程後　研磨工程後　個片化後のイメージ

コンプレッション成形装置で封止した成形品は、チップを露出させるための研磨工程などを経て個片化されます。

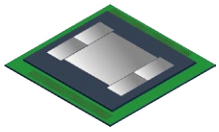
Model FMS4040

自動化・品質向上に貢献するシンギュレーション装置

実装基板は、シンギュレーション装置で切断されます。

基板実装・樹脂封止

YPM1250-EPQは、基板に配置された複数のチップレット製品の樹脂封止化において、生産性向上、高品質化のソリューションを提案しています。



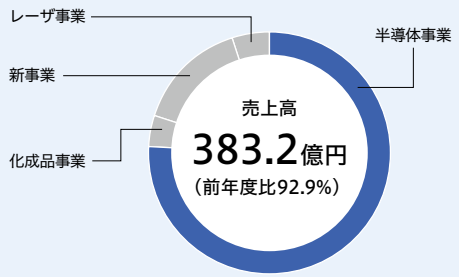
チップレット製品のイメージ

Model YPM1250-EPQ

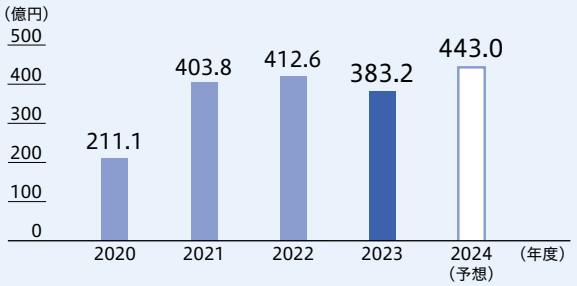
半導体事業

常に技術革新が求められる半導体分野において、最先端技術を世界に発信し、モールディング装置のリーディングカンパニーとして進化し続けています。

売上構成比率



売上高



事業概要

TOWAグループの主力事業で、モールディング装置(樹脂封止装置)、シンギュレーション装置、超精密金型の開発・製造を中心に行っています。

半導体チップをほこりや湿気、衝撃などの外部要因から保護する目的で樹脂によって封止するモールディング技術は、半導体の信頼性を確保するために不可欠な技術です。

当社では、半導体チップの保護を目的に、熱硬化性樹脂をゲート(供給口)からチップの周囲に供給した後に硬化させる従来型の「トランスファモールディング装置」および、顆粒等の形態で供給された熱硬化性樹脂を金型上であらかじめ加熱溶融させて半導体チップを浸した後にその樹脂を硬化させる当社独自の「コンプレッションモールディング装置」の2方式の装置を製造しています。

コンプレッションモールディング装置は、メモリや5G向けの最先端製品の半導体封止に対応しており、まさに今後のニーズに応えられる製品です。

モールディングされた製品を個片化するシンギュレーション装置では、製品を切断し収納する装置を自社開発しています。

樹脂を成形するための超精密金型は、創業時に当社が開発したモジュールシステムから進化してきたもので、数々の超精密金型を市場に供給しお客様から高い評価を得ています。

コンプレッションモールディング装置
Model **PMC2030-D**

2023年度の経営状況

半導体事業における経営成績は、台湾地域を中心に民生品向け投資が低迷したものの、中国地域や東南アジア地域での設備投資は堅調に推移しました。また、当第4四半期から韓国地域での生成AI関連向け投資が本格化したことから、売上高383億24百万円(前連結会計年度比29億44百万円、7.1%減)となりました。

半導体装置事業の強み

当社は、世界に先駆けてマルチプランジャでの全自動半導体樹脂封止装置を開発し、それを業界標準へと導きました。以来、他社の追随を許さないポジショニングで半導体モールディング市場におけるリーディングカンパニーであり続けています。また、内製にこだわっており、お客様のあらゆるご要望に応える体制を整えています。

グローバルに展開する当社ラボラトリでは、AI半導体向けの高速メモリであるHBMに最適なコンプレッションモールディング装置や、先端半導体の後工程プロセス技術であるチップレットや3Dパッケージング技術に最適なトランスファモールディング装置によるお客様の試作評価や共同開発を行っております。また最先端ニーズだけでなく、お客様に近い場所で、開発から供給効率化まで、幅広い開発・生産体制でご要望にお応えしています。

2.5D/3D/チップレット製品に最適な
トランスファモールディング装置
Model **YPM1250-EPQ**

事業戦略

半導体事業における主軸戦略

- 付加価値を活かしたプロセスビジネスの展開により半導体事業の収益力を強化します。
- リードタイム短縮および在庫削減を目的とするMIP（Minimal Inventory & Period）により生産体制・財務基盤の強化を図ります。
- 開発リソースへの積極的な資源投入により顧客ニーズの先取りやSDGs・ESG投資に適った製品の開発をスピード感を持って実行します。
- シンギュレーションとブレードの連携により市場獲得を目指します。

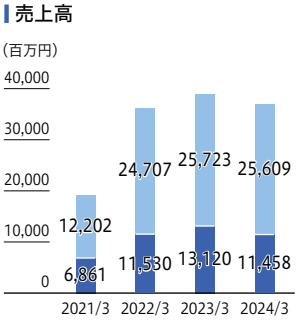
MIPプロジェクト

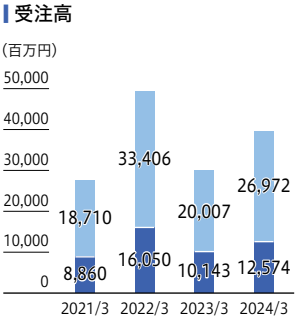
（Minimal Inventory & Period）

- ▶ リードタイム短縮
- ▶ 在庫適正化（生産方式見直し）
- ▶ 先行生産 ⇔ 受注後生産の切替

半導体製造用等精密金型 ＋ **モールディング装置**

民生品向け投資が低迷し売上高は減少したものの、生成AI関連向けにコンプレッション装置の需要が拡大し、通期のコンプレッション装置、金型の受注高と売上高は過去最高に。

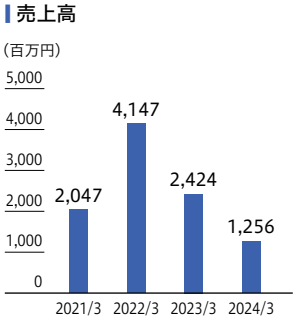


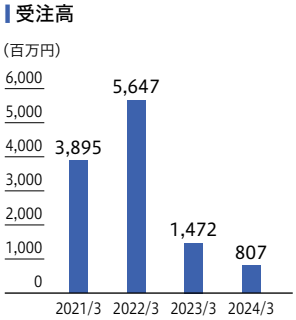


■ 半導体製造用等精密金型　■ モールディング装置

シンギュレーション装置

調整局面にて売上高が減少する中、開発・生産・営業部隊を備えた事業本部体制に移行。専門体制により、市況回復と同時にシェア拡大を目指す。





■ シンギュレーション装置

Topics　カスタマーリレーションの強化

TOWA Technology Exhibition開催

2023年12月から翌年1月にかけて、本社・工場にてTOWA Technology Exhibition 2023を開催いたしました。

先端パッケージ向けや省人化などテーマに沿ったTOWAの製品や技術を紹介し、国内外から多くのお客様にご来場いただきました。本社・工場に先立ち、2023年9月から10月にかけて、マレーシア工場においても開催しました。

SEMICON JAPAN 2023に出展

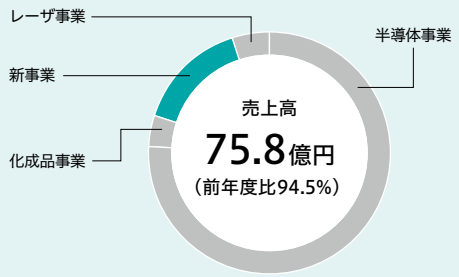
2023年12月13日から15日の3日間、東京ビッグサイトにて開催されたSEMICON JAPANに出展しました。

技術革新の核となりつつある生成AI向け半導体やトレンドの車載半導体など多様なパッケージに対する成形技術のご提案や、シンギュレーション技術・レーザ技術、さらにはお客さまへのサポート体制のご紹介を行いました。

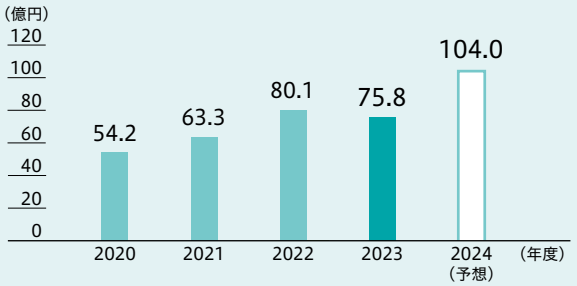
新事業

コア技術を活かし、新たな市場の創造と事業化にチャレンジしています。

売上構成比率



売上高



事業概要

半導体分野で培ってきた金型製造技術を活用して新事業を展開し、市場における新たな価値創造を目指しています。

- **TSS事業(トータルソリューションサービス)**…当社半導体製造装置のアフターサービスや改造・修理、中古機の販売までトータルな提案を行っています。
- **工具事業**…金型製造メーカーのノウハウが蓄積された自社開発の工具を販売しています。
- **受託事業**…TOWAオリジナルの金型表面処理技術を応用したコーティングや、超精密金型で培った超精密・微細加工技術、EF(超精密電鋳)加工技術を医療や光学部品、家庭用品などに応用・複合させた受託加工事業を展開しています。

事業戦略

新事業における主軸戦略

- コア技術の応用展開により新たな柱となる事業を独立させポートフォリオの変革を図ります。
- TOWAオリジナル商品の創出により新たな事業化を実現します。
- TSS事業を通じてお客様の安定稼働に貢献し、長期的関係を確保します。
- グローバル生産拠点を活用した原価低減により競争力強化とシェア拡大を図ります。

2023年度の経営状況

新事業における経営成績は、年間を通じてPCやスマートフォンなど民生品の需要が低迷したことから、第3四半期まで、半導体製造装置の部品販売や改造などのTSS事業の売上は低調に推移しました。一方、第4四半期は顧客工場の稼働率改善を背景に、TSS事業の売上が大きく伸長した結果、売上高は75億78百万円(前連結会計年度比4億38百万円、5.5%減)となりました。

新事業の強み

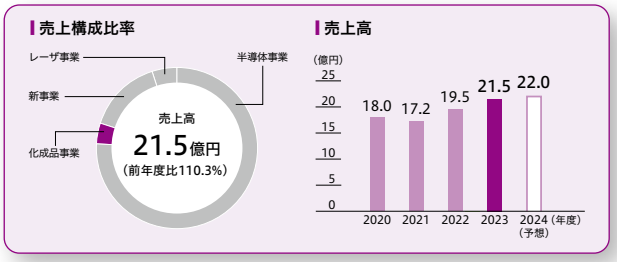
超精密金型の製造技術・ノウハウ・専門能力を持った人財という独自のリソースを有することが市場において大きな強みとなっています。コーティング、ナノテク、ツーリングなどの技術は、多様な分野で利用されうるため、今後も幅広い領域での戦略が望めます。当社はそれを可能にする環境や設備を自社で開発し、整備しています。

当社の切削工具は、自社開発としてお客様の様々な被削材・加工内容に対応・ご提案が可能です。コーティング開発品については、反射防止や超撥水といった機能を付加して金型用途以外への展開もすすめています。受託加工ビジネスではこれらTOWAのコア技術を応用し、様々な分野のお客様の課題解決に貢献します。

ナノレベルの加工を支える設備と環境も強みの一つ(超微細加工設備)

化成品事業

**医療を中心に、さまざまな産業分野で利用される
ファインプラスチックで未来に貢献します。**



2023年度の経営状況

化成品事業における経営成績は、コロナ影響緩和に伴い、医療提供体制が回復し医療用成形品の需要が増加したことから、売上高21億50百万円(前連結会計年度比2億円、10.3%増)、営業利益4億58百万円(前連結会計年度比70百万円、18.1%増)となりました。

事業概要

化成品事業では、医療、情報通信、情報家電、光学などの分野で活用されているファインプラスチックの成形を行っています。医療機器部品の射出成形および組み立てが主力となっており、1983年に化成品部門の専業化を図るべく設立したグループ会社の株式会社バンディックで製造しています。全ての成形・組立をクリーンルームで行っており、安定して高品質な成形を実現しております。

事業戦略

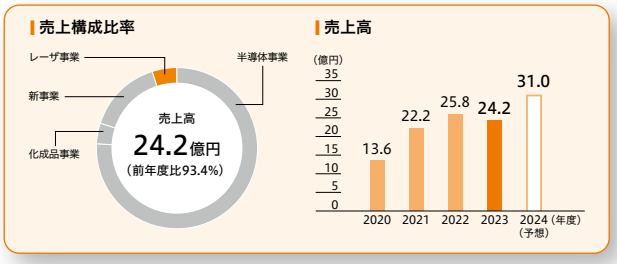
化成品事業における主軸戦略

- 化成品事業で培ったコア技術をもとにTOWAブランドの付加価値を高め事業規模を拡大します。
- 品質・コスト・納期を更に追求し安定した収益体質を構築します。
- 医療機器のライセンスを活かし商品の多様化を図ります。

電動射出成形機を
40台以上所有し、
全てクリーンルームで成形

レーザ事業

**レーザ関連技術と半導体製造の後工程技術を融合し、
新たな市場を目指します。**



2023年度の経営状況

レーザ事業における経営成績は、事業拡大や開発体制強化に向けた人財強化に伴う人件費の増加などにより、売上高24億17百万円(前連結会計年度比1億69百万円、6.6%減)、営業利益1億5百万円(前連結会計年度比1億41百万円、57.2%減)となりました。

事業概要

グループ会社であるTOWAレーザーフロント株式会社にてレーザトリマ、ウェハマーカ、レーザ溶接機を製造しております。今後、レーザ関連技術と半導体製造を融合させ、新たな市場を目指してまいります。

半導体ウェハに品名、ロット番号等の管理番号をレーザマーキングするウェハマーカ

事業戦略

レーザ事業における主軸戦略

- アプリケーション強化により新商品を創出し、「価値創造」と「価値獲得」を図ります。
- TOWAグループの生産・販売拠点を活用し生産能力アップ・原価低減と販売体制・サービスの強化を図ります。
- 顧客プロセスを徹底追求し、課題解決型ビジネスができる企業へ成長します。

CHAPTER 04

特集3 社外取締役座談会

専門的な知見を活かし、経営に関する監督、提言を通じて企業価値のさらなる向上に貢献していきます

3名の社外取締役による座談会を開催しました。TOWAの経営のあり方に対して、忌憚のない意見を語っていただきました。

事業が急成長している中にあって、社外取締役としての使命を果たしていきます

和氣　TOWAにおける社外取締役の役割として、当然のことではありますが、株主に代わって取締役の職務執行や取締役会の議事運営を監督することだと認識しています。そのためには情報収集が重要であるのに対して、自ら得ることができる情報は限られています。また、公認会計士という立場から決算書の正確性を確認するわけですが、資料の数字を見るだけで必ずしも真実を把握できるとは限りません。そこで常に心がけているのは、社内のさまざまな人と直接話をすることです。人々との対話を通じて本音や真実を知ることができると考えます。

特に内部統制の実態を把握する上では、事象に対してどのような背景があるのかなどを含めて、積極的なコミュニケーションが不可欠です。雑談を含めてさまざまな話題について会話を行う過程で、その人の本音を引き出し、物事の真相に迫ることができると考えます。幸いなことに、TOWA

では意見を自由に交換できる環境が整っており、仕事がやりやすいと感じます。

後藤　私は1997年から京都市内で弁護士として活動しており、クライアントは個人のお客様をはじめ、中小企業や地方自治体など多岐にわたります。私の強みは法律の専門知識に加えて、組織に縛られずに多角的な視点から客観的に物事を見る点です。また、組織の空気を読まずに意見を率直に言うことを心がけています。

和氣さんと同じく、社外取締役として株主の利益を代弁し、経営を監督することが重要と認識していますが、一方で業務について細かな指摘になりすぎないようにバランスを取ることに気をつけています。また、取締役会では新たな制度の導入に際して法的な観点から意見を述べることで、経営者とは異なる視点の提示に努めています。場合によっては、株主や若手社員の立場から意見を申すこともあります。

田中　私は和氣さんと同じく公認会計士です。大手監査法人で大企業の内部統制や財務諸表の監査、そしてアドバイス業務を長らく手がけてきました。その経験を活かし、TOWAに役立つ視点を提供することを常に心がけています。

社外取締役として、社内の方が言いづらいことを代弁する役割が大切だと考えます。後藤さんがおっしゃる通り、経営を監督する立場として忖度せずに率直な意見を述べるようにしています。一方で、我々は経営陣を支援する応援団でもあると考えます。経営のアクセルとブレーキの役割を果たしつつ、経営陣の前向きな取り組みの背中を押していきたいと考えます。

同時に、従業員や株主、債権者、投資家といったさまざまなステークホルダーの立場を考慮し、バランスを取ることが欠かせません。特に女性従業員の活躍に関しては、私を含めて二人の女性役員がいることで、女性の視点からの意見や提言も積極的に行っていければと思います。こうした多角的な視点を持つことで、より良い経営サポートができると考えています。

グループ全体が未来に向かって チャレンジしている点に力強さを実感

田中　TOWAの社外取締役に就任して丸二年が経ちました。ものづくりに全力を注いでいる姿勢に共感するとともに、何事も前向きでワクワクするような社内の雰囲気を好ましく感じています。今後、世界の半導体市場が急速に成長していく中で、業界の未来を前向きにとらえている姿勢が魅力です。また、半導体製造装置が事業の中心であるとはいえ、それだけに留まらない多様な製品を作り出している点にも注目しています。

2032年には1,000億円の売上目標を掲げていることについて、今後は組織が大きくなることから、ガバナンスの効率的な実行が課題になると考えます。特に人財の育成や海外拠点の独立機能、本社との連携のバランスが重要です。これらの課題に対して、取締役会でのさらなる議論が必要だと感じています。現状、取締役会の運営は効率的に行われていますが、企業規模の拡大にともない、より多くのプロジェクトが発生することから、運営をいかに効率よく行っていくかについて検討していかねばなりません。

後藤　TOWAに初めて来た時の印象として、次世代をフィールドに、顧客ニーズの1/4歩先を見すえたクォーターリードで、新しい未来を創造するという経営姿勢に基づいて、グループ全体が未来に向かってチャレンジしている点に力強さを感じました。岡田社長をはじめ、各部署から次々とアイデアが生まれ、それが形になるまでのスピードが速いことに驚いたものです。また、自社の製品に対する圧倒的な自信を背景に、高い技術力がお客様から高く評価されている点を喜ばしく思います。

今後、企業として急成長を遂げていく中では、少人数で大きな役割を担っている現在の体制から、規模に応じた人員配置や組織形成が課題になります。現時点では、だれに何を聞けばいいのかがすぐに分かる環境が整っており、細かいことでも質問しやすい雰囲気があります。しかし、今

後は情報の流通や確認が難しくなっていくかもしれません。組織の拡大に対応していくための仕組みづくりが必要だと感じています。これからも現状の良さを維持しつつ、成長に対応するための対策を講じていくことが重要です。

和氣　TOWAの良いところとして、人の良さが際立っています。真面目で誠実な方々が多く、どこの拠点を訪れても真摯な対応と一生懸命な姿勢に感心しています。一方、課題としては、やはり人財の確保と育成が重要だと思います。半導体業界は一定のサイクルで景気の浮き沈みが到来し、その影響による人財不足の時期にどう対応するかが大きな課題です。

最近では若い従業員が増えてきて、食堂の雰囲気が変わってきました。私が社外取締役に就任した頃は売上高は200億円に満たなかったのに対して、今では500億円に達しており、毎年10%の成長を続ければ7年後には1,000億円超になると確信しています。これからも成長し続けていく上では、会社としての魅力をさらに高め、仲間を増やすことが重要です。岡田社長が常々おっしゃっているように、「TOWAファンを増やそう」ということであり、それによってTOWAの明るい未来を築くことができると見込んでいます。

中長期の成長を見すえて、将来のガバナンスのあり方を議論する機会が必要

和氣　私は2012年に社外監査役に就任して以来、TOWAの経営に関与してきました。就任当初、情報提供のあり方に関する課題について提言したところ、ただちに情報交換会を開始するなど、迅速に対応していただきました。取締役会と同日に設けられているこの情報交換会は、岡田社長を交えて情報共有だけでなく、忌憚のない意見が飛び交い、M&Aの話なども率直に議論できる場となっています。

さらに、毎月一回、経営企画本部・管理本部の担当役員との情報共有の場があり、直近の情報などを説明していただけますし、会議の前には同役員より前回からの変更点などを事前に確認できる体制になっています。また、取締役会や経営会議の資料はクラウドに保存されており、自分の事務所からアクセスできます。議題や資料を事前に確認することができることから、しっかり準備を整えて会議に臨むことができます。このように、情報の透明性が確保され、意思決定がスムーズに行える環境が整っていることに感謝しています。今後こうした情報共有の仕組みを活用して、TOWAのさらなる発展に寄与していきたいと考えます。

田中　取締役会における議案について申しますと、直近の課題や投資案件については議論が盛んであるのに対して、事業が拡大する中で将来、経営体制をどうしていくかといった長期の議論はやや不足しているように思います。取締役会で取り上げるのは難しいかと思いますが、非公式の場でもよいので、中長期の成長を見すえてどのようなガバナンスのあり方が望ましいのか、といった議論を今から行っていくことは有意義であると思います。

後藤　取締役会の運営については適切に行われていると考えます。ただし、前回の実効性評価では、一部の方から取締役同士の相互監督やグループ全体の内部統制およびリスク管理体制の監督について、より強化すべきとの回答があった点がやや気になっています。この点、社外取締役がもっと積極的に監督を行うべきだと暗に示されているように感じたことから、今後、配慮すべきと考えています。

女性従業員が活躍できる企業風土の醸成が課題

田中　和氣さんがすでに語っている通り、組織が大きくなるに連れて、人財の確保と育成が重要になっていきます。人財の採用についてはこの一年で株価が上がり、知名度も向上しているため、取り組みやすくなっていると感じています。

一方で、女性従業員の活躍については課題と言わざるを得ません。現在、女性管理職の比率は3.5%にとどまってい

ます。女性が長く働いて、かつ活躍できる機会を提供することが重要だと考えます。そのための制度は整っている一方で、組織文化を変えていく必要があります。女性が活躍するのが当たり前の風土を作ってほしいと思います。現状、海外の拠点では多くの女性管理職が活躍していることから、日本国内でも同様の状況を目指したいです。私たち社外取締役が積極的に発言していくとともに、女性従業員に対するサポートのあり方を考えなければなりません。多くの女性が管理職になるための意識変革とロールモデルを生み出すことで、女性従業員が管理職に挑戦しやすい企業を目指していければいいですね。

後藤　女性の管理職が少ない理由の一つは、管理職になる年齢層の女性がまだ少ないことです。また、多くの役員に海外駐在経験があるのに対し、女性には海外駐在のハードルが高く、それが管理職に就く上での障壁になっているように思います。

もっとも、コロナ禍でオンラインでの業務が普及したことで、海外に駐在しなくても海外の情報を取得できる環境が整いつつあります。このような新しい方法を取り入れることで、女性もハンディを乗り越えられる可能性があります。40代後半以上の女性従業員が少ないという現状があるものの、次の世代が管理職になる時期には、もっと多くの女性が管理職に就くことを期待しています。

現在の若い世代、特に理系の女性たちは、結婚後も仕事を続けることを前提にキャリアプランを立てています。半導体業界に進む女性も同様で、一生働くことを視野に入れています。これから、管理職を目指す女性が増えてくると信じていますし、そのような女性を支援するために、私たちも知恵を絞って支援策を考える必要があります。

だれもがTOWAの一員であることを誇りに思えるような組織を目指していきたい

後藤　私としては、企業規模が大きくなり、売上が倍増することを考えると、業務執行の監督においてより慎重になる必要があると感じています。これまでは経営陣の背中を後押しすることが多かったのですが、企業が大きくなるにつれて見えない部分も増えてくるため、監督の重要性が増しています。企業として成長に向かう中で、私たちは必要に応じてブレーキを踏む役割を果たさなければなりません。目標達成だけでなく、慎重な監督を心掛けることが重要だと思っています。

田中　企業規模が大きくなる中では、国内外の拠点のガバナンス体制が課題になると感じています。私や和氣さん、後藤さんが持つ知見を通じて積極的に支援していきたいと思います。また、私たちがリスクに気づいた場合は、いち早く共有できますが、大切なことは、リスクを早期に発見できる組織づくりです。これにより、ガバナンスの質を高め、より強固な体制を築くことができると信じています。

和氣　今後、TOWAがさらに大きなグローバルカンパニーグループを目指していくには、セクショナリズムを避けて互いに協力する企業文化の醸成が重要です。人間は弱さを持っており、だれでも過ちを犯す可能性があります。その弱さを克服するのには仲間とのコミュニケーションが大切です。

公認会計士として多くの事例を見てきた経験から申しますと、不正行為を未然に防ぐためには、日常的な声かけが有効です。組織全体で統制を整え、コミュニケーションを大切にしながら、皆で協力して経営目標の達成を目指したいものです。

企業の究極のあるべき姿とは、売上や利益だけを追求するのではなく、すべてのステークホルダーが最高の効用を感じられる環境を作ること、すなわち「パレート最適」の追求だと考えます。従業員や取引先、株主など、すべての関係者が満足し、納得できる状態を目指すべきであり、しかも環境の変化に応じてどこまでも維持できる点が重要です。たとえ困難な状況に直面したとしても、だれもが「この会社で良かった」と思えるような状態を目指したいです。そして、多くの人々がTOWAの一員であることを誇りに思えるような組織を作っていければ良いですね。

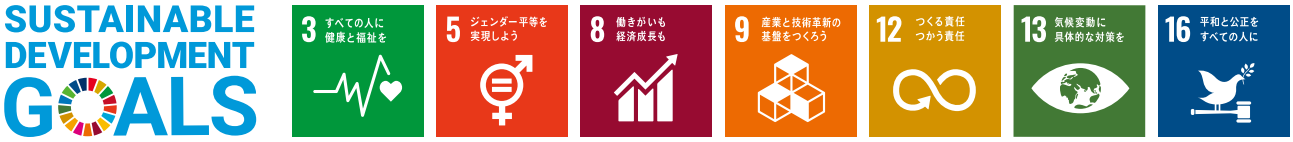
TOWAグループのサステナビリティ

サステナビリティ基本方針

私たちTOWAグループは、経営理念、行動基準、環境方針等に基づき、「クォーター・リード」の精神で産業の発展に多大な貢献を果たすとともに、お客様、株主・投資家、取引先、従業員とその家族、地域社会など、全てのステークホルダーとの強固な信頼関係を構築し、企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指します。

TOWAが注力するSDGs

当社は、国連が定める「持続可能な開発目標（SDGs）」における17のゴールのうち、特に事業との関連性が高い以下の項目について、重点的に貢献してまいります。



TOWAのマテリアリティ	具体的な事例			関連するSDGs項目	ESGとの関連
	取り組み項目		活動内容		
社会への貢献を通じたTOWAの価値創出 環境負荷低減への貢献	独自技術製品の開発・製造・販売	樹脂効率の良い装置の開発	創業後まもなく樹脂の使用効率を高めるマルチプランジャ方式を開発、樹脂の廃棄量を大幅に削減。2009年には樹脂効率100%（廃棄量ゼロ）を達成する独自のコンプレッション方式を開発しました。	8 9 12 13	E 環境 S 社会
		ゼロディフェクトへの取り組み	次工程に不良品を流出しない、不良品をつくらない、未だ見ぬ不良を見つける、のステップで不良をゼロにする製品の開発に取り組んでいます。		
		カスタマーエクスペリエンス（顧客体験）の取り組み	お客様の体験価値（購入までの過程、使用する過程、購入後のフォローアップなど）と従業員の体験価値（やりがい・働きがいなど）向上の両方の視点で取り組み、企業の成長を図っています。	8	
	環境・健康への貢献	地球環境保全への取り組み	● 電気や紙など資源の使用量をモニタリングし、資源の使用量削減と業務効率化を図っています。 ●「グリーン調達ガイドライン」「グリーン設計規定」を定め、資材調達および設計・製造の両面で環境保全に取り組んでいます。 ●「化学物質管理規定」を定め、「安全データシート」に基づき、当社製品に使用される化学物質の管理を厳格に行っています。 ● 国内の半導体製造装置事業で使用する全ての電力を、再生可能エネルギー由来の電力に切り替え、CO_2排出量削減に取り組んでいます。 ● 社内集約出荷や梱包材のリユースを推進し、CO_2排出量や廃棄物の削減に取り組んでいます。	7 12 13 15	

TOWAのマテリアリティ	具体的な事例			関連するSDGs項目	ESGとの関連
	取り組み項目		活動内容		
社会への貢献を通じたTOWAの価値創出 環境負荷低減への貢献	環境・健康への貢献	中古機販売事業	TOWATEC(株)では役目を終えた半導体製造装置の買取り・再生・販売・サポートを一貫実施。お客様のニーズと資源の有効活用に寄与しています。	8 9 12 13	E 環境 S 社会
		人々の健康への貢献	●(株)バンディックでは医療機器用プラスチック成形品や、厚労省の許可を受けた高度管理医療機器を製造しています。 ●元阪神タイガース監督の矢野燿大氏による「39矢野基金」活動に賛同し、筋ジス患者や児童施設への支援を行っています。 ●社員等を対象とした献血事業への協力を行っています。	3 8 9 17	
健康経営と労働安全衛生の推進	人財マネジメント	健康経営	●「健(すこやか)漲(みなぎ)りて業(なりわい)壮(さかん)なり」をモットーとする「TOWA健康宣言」を策定して社員の健康維持・増進に取り組んでいます。 ●社員間コミュニケーションの促進、健康・教養・趣味の向上、心身の錬磨を目的にTOWAクラブ活動・各種会社行事を行っています。 ●2015.12.1から従業員50名以上の全事業場に対してストレスチェックを実施しています。	3 8	S 社会
		働き方	●「TOWA働き方改革ポリシー」を策定(2020.4.1)、社員一人ひとりの健康と働きがいを第一に考え、働き方改革を重要な経営課題の1つとしました。 ●産休・育休後の職場復帰支援を推進しています。 ●ワークライフバランスの醸成を支援。有給休暇取得を奨励する「クリエイティブ・ホリデー」制度の運用を推進しています。	3 5 8 16	
人財育成と多様な人財の活躍推進		人財育成	|自己啓発・資格取得・各種表彰制度| ●全社員を対象に毎年2回の通信教育受講を奨励し、自己啓発活動を支援しています。 ●社員へのTOEIC IPテスト受験を奨励し、取得スコアに応じ表彰も実施しています。 ●勤続や貢献に応じた表彰ほか、「チャレンジ賞」「グローバルTOWA賞」を設けています。	4 5 8 9	
ガバナンス体制の更なる強化	国際社会の一員としての責任の遂行	コンプライアンス	●コンプライアンス教育、輸出管理教育、ハラスメント研修、環境教育ほか社内教育を実施しています。 ●専用メールアドレス(女性社員専用あり)を設けて内部通報制度を整え、調査委員会が調査を行います。 ●「人権方針」「腐敗防止方針」に基づき、適切な事業活動に努めてまいります。	5 8 10 16	G ガバナンス
		コーポレートガバナンス	コーポレートガバナンス・コードに沿った経営を実践し、他社の状況や議決権行使助言会社の方針等を踏まえて、より実効的なガバナンス体制を模索しています。	8 16	
		リスクマネジメント	社内リスク管理の最高機関として、社長を議長とする「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスク抽出や評価を実施しています。	8 12 16	

E
環境

TOWAグループの環境への取り組み

基本的な考え方

TOWAグループは、持続可能な循環型社会を実現するために、各事業所において環境マネジメントシステムを構築し、グループの事業活動に起因する環境負荷の低減に努めています。

製品開発においても、環境負荷の低減に配慮した設計・開発をテーマに、製品の環境性能向上に努めています。

環境方針

TOWA 株式会社は、「地球環境の保全」が人類共通の重要課題であると認識し、事業活動を通じて、環境に配慮した「技術開発」により、「新製品・新商品・サービス」を市場へ供給し、地球環境負荷軽減に貢献します。

1. 当社は、事業活動および製品やサービスが地球環境に与える影響やその要因を把握し、地球環境汚染の予防、地球温暖化対策に努めます。
2. 当社は、事業活動および製品やサービスに関わる環境関連の諸法令・規制を順守します。
3. 当社は、事業活動および製品やサービスにおいて、次の事項を重点テーマとして取り組みます。
   (1) ライフサイクルを考慮した、環境負荷の少ないグリーン設計の推進
   (2) サプライチェーンへの働きかけによる、環境負荷の少ないグリーン調達の推進
   (3) 環境負荷化学物質の厳格な管理
   (4) 事業活動における省エネ・省資源への取組み継続
4. 当社は、「環境方針」を達成するために、戦略目標を定め、具体的に実現するための手段を策定し、その成果を定量的に測定する指標を定め、継続的改善に取り組みます。

2017年4月1日
TOWA株式会社　代表取締役社長　岡田博和

気候変動対策　脱炭素の取り組み

当社グループは、気候変動の原因とされる温室効果ガスの排出量削減を重要な課題と捉え、CO_2排出量削減目標を策定し、グループ全体でカーボンニュートラルを目指して取り組んでいます。

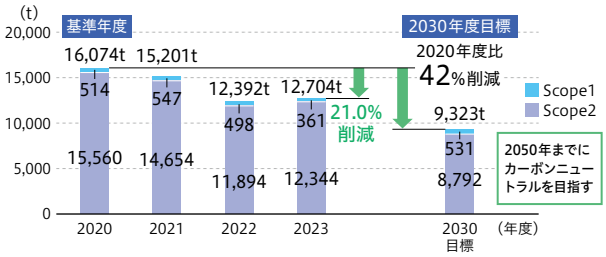
2023年度のグループ全体のScope1+2のCO_2排出量は、生産拠点として直近グループに加わったTOWAファインとTOWA TOOLの排出量を算定に加えたことなどから、前年度より312tの増加となりました。なお、太陽光パネルによるCO_2削減については、南通工場の太陽光パネルが稼働を開始するなど、前年度より893t拡大しています。今後も更なる再エネ活用の推進や既存施策の継続などにより、CO_2排出量削減の取り組みを進めてまいります。

TOWAグループのCO_2排出量削減目標

- 2030年度において自社(Scope1+2)のCO_2排出量を2020年度比42%削減します。
- 2050年までに実質ゼロ(カーボンニュートラル)を目指します。

Scope1：自社による温室効果ガスの直接排出
Scope2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

CO_2排出量実績と目標



TCFDの枠組みに基づく情報開示の取り組み

当社グループは「気候変動」を重要な経営課題の一つとして認識し、2022年5月にTCFD※の提言に賛同を表明しました。提言内容に沿って、気候変動に関連するガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の項目について開示しています。ガバナンスでは環境経営の推進体制を整え、取締役会で気候変動に関する基本方針等の審議・決定、リスク管理を実施しております。

※「気候変動関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）」の略称。TCFD提言は企業等に対し、気候変動関連情報の開示を推奨している。

TOWAの描く各シナリオの世界観

戦略の検討においては、評価対象を半導体関連製品を含むサプライチェーン全体として将来の気候変動が当社事業へもたらすリスク・機会を整理し、1.5℃シナリオを含むシナリオ分析を定性的・定量的に実施することにより当該リスク・機会の影響を評価しております。シナリオ分析については、今後の環境の変化を踏まえ、定期的にレビューしていきます。

リスク管理については、社長を議長とする「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスクの抽出や評価を実施しています。

指標と目標については、環境目標の中で「CO_2排出量の削減」を目標として設定しCO_2排出量の削減に取り組んでおり、その中でScope1、2に関するCO_2排出量の測定・開示を行い、活動実績を公表してまいります。

気候変動リスクの低減に向け、TCFDの枠組みに基づき、ガバナンスを強化し、リスク・機会の抽出や財務的影響の把握を通じて対応を推進するとともに、さらなる情報開示の充実を図ってまいります。

詳細につきましては、下記「TCFD提言に基づく開示」のウェブサイトをご参照ください。

https://www.towajapan.co.jp/jp/company/environment/#TCFD

設定したシナリオの概要

	設定シナリオ	
	1.5℃シナリオ	現行シナリオ（現状維持シナリオ）
想定される事業環境	**リスク** ● 1.5℃の世界の実現に向け、全世界で炭素税の導入が進み、2030年で先進国では130$/t-$CO_2$を超える水準に。 ● 顧客の環境意識が高まり、製造装置の省エネ・省CO_2化が厳格に求められるようになる。ただし、省エネ技術開発は大きく進展する。 **機会** ● EV販売台数の伸長や再エネ機器の普及、また顧客の国際イニシアティブ（RE100、SBT等）の達成ニーズの高まりに伴い、半導体製造装置の需要は現状よりも大きく拡大。 ● 経済性に加え、サーキュラーエコノミーの概念の普及に伴い製造装置の中古市場は現状よりも大きく拡大。	**リスク** ● 台風被害の増加、洪水頻度の増加等激甚災害の頻度増加に伴い、自社工場・サプライチェーン拠点の被災リスクが高まる。 **機会** ● EV販売台数の伸長や再エネ機器の普及、また顧客の国際イニシアティブ（RE100,SBT等）の達成ニーズの高まりに伴い、半導体製造装置の需要は拡大傾向も1.5℃シナリオに比べると伸びは緩やかとなる。 ● 経済性の観点から製造装置の中古市場は拡大傾向も1.5℃シナリオに比べると伸びは緩やかとなる。
参照シナリオ	● IEA：WEO2021 NZEおよびSDS ● IPCC 第6次評価報告書 第1作業部会報告書：SSP1-1.9, SSP1-2.6	● IEA：WEO2021 STEPS ● IPCC 第6次評価報告書 第1作業部会報告書：SSP3-7.0, SSP5-8

E
環境

TOWAグループの環境への取り組み

CO_2排出量算定と削減の取り組み

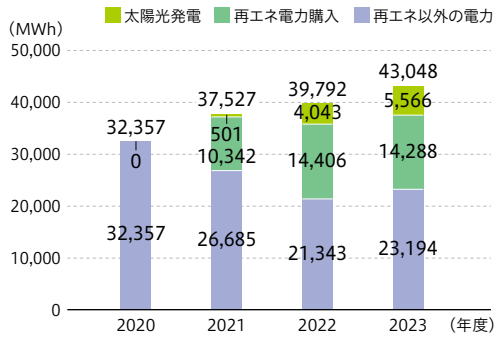
再エネ電力活用の推進（Scope2の取り組み）

TOWA グループでは、自社で使用する電力について、再生可能エネルギー由来への転換を積極的に推進しています。創エネとして太陽光パネルの導入を2022年1月から進めており、各工場で使用する電力に活用しています。2023年度は、前年度末に中国南通工場に導入した設備の本格稼働と、4月に子会社化したTOWA TOOL（マレーシア）の設備を加えて、5,566MWh（前年度比+37.7%）を発電しました。これはCO_2に換算すると約3,300tの排出量削減になります。

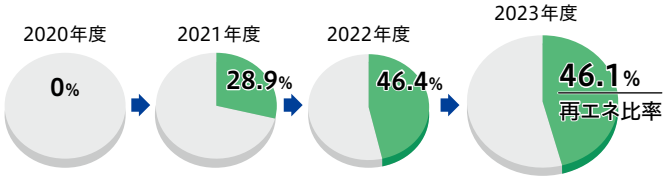
また、国内の主要事業所（本社・工場、京都東事業所、九州事業所）では、2021年7月から、電力会社が提供する再生可能エネルギー由来の電力メニューへの切り替えを継続しています。

これらにより、2023年度は、当社グループの生産拠点において、全使用電力に占める再生可能エネルギー由来電力の比率（再エネ比率）は46.1%となっています。今後もグループ内における再生可能エネルギーの活用拡大に努めてまいります。

電力使用量



グループの生産拠点で使用した電力に占める再エネ由来電力の比率



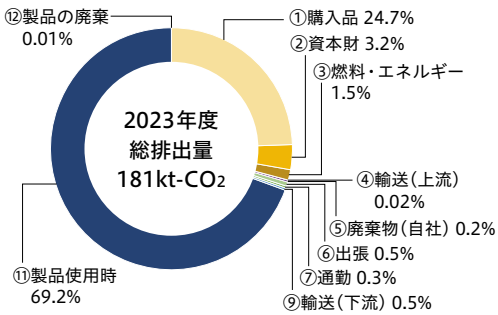
南通工場の太陽光パネル

Scope3排出量の算定

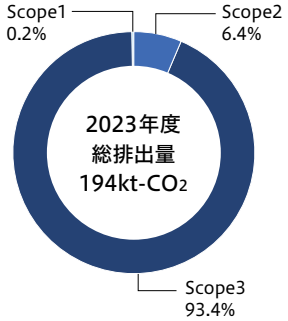
Scope1および2、すなわち燃料や電気の直接使用に関わる範囲のCO_2排出量削減の取り組みに加えて、企業活動全体に取り組みを広げるために、2022年度実績より当社グループのScope3排出量の算定を開始しました。Scope3排出量は、購入品の製造や従業員の出張といった企業活動の上流から、販売した製品の輸送、お客様使用時の電力消費、製品の廃棄といった下流にわたる広くサプライチェーン上の企業活動に伴うCO_2排出量を算定したものです。

今後は、排出量の多いカテゴリである製品使用時の排出を中心に算定精度の向上を図り、製品の省エネ化や廃棄物削減などを通じて、お客さまをはじめ社会全体への貢献をさらに推進してまいります。

Scope3排出量



Scopeの割合



2023年度のScope3排出量実績

カテゴリ名	排出量実績（千t-CO_2）	算定範囲	算定方法
Scope3合計	181.01	–	–
1. 購入した製品・サービス	44.63	※1	購入金額に排出原単位を乗じて算出。
2. 資本財	5.80	※2	設備投資額に業種ごとの排出原単位を乗じて算出。
3. 燃料・エネルギー関連	2.64	※1	エネルギー購入量に排出原単位を乗じて算出。
4. 輸送、配送（上流）	0.04	※1	製品の生産拠点国内における輸送について、輸送重量×距離に排出原単位を乗じて算出。 なお、購入した製品・サービスに関する輸送はカテゴリ1で算出。
5. 事業から出る廃棄物	0.30	※1	廃棄物排出量に廃棄物輸送段階を含む廃棄物種類別の排出原単位を乗じて算出。
6. 出張	0.99	※1	単体は交通費支給額に交通手段別排出原単位を乗じて算出。グループ会社は従業員数に排出原単位を乗じて算出。
7. 雇用者の通勤	0.58	※1	従業員数、営業日数に都市区分ごとの排出原単位を乗じて算出。
8. リース資産（上流）			Scope1、2にて算出。
9. 輸送、配送（下流）	0.82	※3	カテゴリ4を除く製品の輸送について、輸送重量×距離に排出原単位を乗じて算出。
11. 販売した製品の使用	125.19	※3	販売した製品種類ごとの年間消費電力と製品寿命を推計・設定し、CO_2排出係数を乗じて算出。
12. 販売した製品の廃棄	0.02	※3	販売した製品の重量に廃棄物種類・処理方法別の排出原単位を乗じて算出。

10. 販売した製品の加工、13. リース資産（下流）、14. フランチャイズ、15. 投資 は、対象となる活動などが無いため対象外とした。
※1 主要生産拠点　国内：本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWAレーザーフロント
海外：TOWA韓国、TOWAM、TOWA半導体設備（蘇州）有限公司、東和半導体設備（南通）有限公司、TOWAファイン、TOWA TOOL
※2 連結
※3 半導体事業およびレーザ事業において販売した製品

使用した排出係数やScope1,2の情報などはこちらからご覧ください。 **https://www.towajapan.co.jp/jp/company/esgdata/**

活動内容・取り組み事例

グリーン調達、グリーン設計、グリーン購入の取り組み

当社は環境マネジメントシステム（EMS）認証の一環として、「グリーン調達ガイドライン」および「グリーン設計規定」を定め、資材調達および設計・製造の両面においてRoHS 指令規制物質への対応や環境負荷物質の低減に取り組んでいます。また、製品に関わるサプライヤーや環境側面に大きく関わる業務委託先等には重要度ランクに応じて当社の環境方針、各種手順書、グリーン調達ガイドラインを配布して遵守をお願いし、サプライチェーンを通じての環境保全に取り組んでいます。これからも環境に配慮した当社製品の設計・開発に努めてまいります。

ロジスティックスにおける取り組み　集約出荷・梱包材

当社は、仕入先や協力会社から入荷した荷物に使用されている梱包材は廃棄せず、種類別に仕分け・保管し、リユースを推進しています。昨年度は、この取り組みの更なる推進のため、オリジナルのSDGsシールを作成して、リユースを行っている梱包資材・荷物に貼付し、お客さまをはじめとする関係先にご理解をいただきながらリユース率向上を図っています。また、海外グループ会社への製品出荷を集約して行う取り組みも推進しています。昨年度は依頼件数の10.0%を集約し輸送件数を削減しました。ロジスティックスにおいては、これらの取り組みのほかに、エコ梱包、廃棄物削減、作業性改善等にも引き続き取り組んでいます。

サステナビリティ・リンク・ローンの活用

当社は、2022年に株式会社京都銀行とサステナビリティ・リンク・ローンの融資契約を締結し（融資額1,200百万円、融資期間5年）、長期ビジョン「TOWAビジョン2032」の成長戦略における投資等に活用しています。2023年度につきましては、ESG戦略と整合した取り組み目標「サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPT）」をクリアし、設定されたインセンティブを獲得することができました。

S
社 会

TOWAグループの社会への取り組み

基本的な考え方

ものづくりや製品開発における品質向上や安全安心だけでなく、全ての従業員とその家族の健康と幸せを追求するため、多様な個性を尊重した働き方を推進します。また、SDGsの考え方に基づき、地域の安全や健康増進、活性化のために社会的責任を果たします。

人的資本への取り組み

TOWAは「社員＝財産」と考えており、社員１人ひとりの健康と働きがいを第一とし、人財育成や健康経営の推進に取り組んでいます。人財の多様性の確保を含む人財育成に関する基本方針と社内環境整備に関する方針を次のように定めて中長期的な企業価値向上に努めています。

人財育成の基本方針

TOWAは、『“挑戦”し続ける』行動により『“変革”をもたらす』企業文化を次世代へ継承していくことが、企業発展の源泉と考えています。多様な人財それぞれの挑戦に対する支援が、企業の成長に繋がり、社員自らが学ぶ文化が醸成され、自律的に成長可能な組織が実現すると考えています。

このように、TOWAでは、『創業者イズムを継承し、絶えず挑戦し続け、変革をもたらす人財』を輩出し続けることを目指しています。

社内環境整備方針

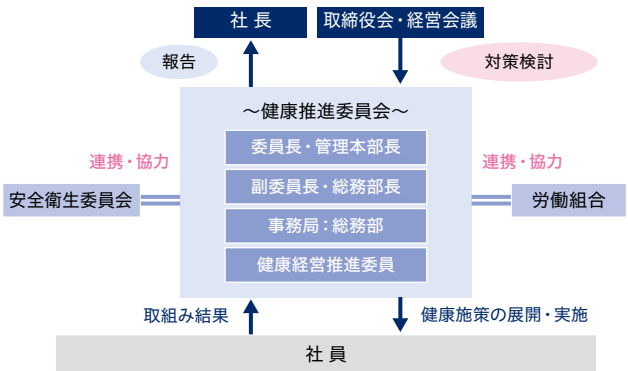
『健（すこやか）漲（みなぎ）りて業（なりわい）壮（さかん）なり』

私たちTOWAは、『健康』であれば心身共に『漲る』ものが生まれ出し、『社業』も栄える事を念頭に、社員全員の健康維持・増進、笑顔溢れる職場環境作りに取り組んでいます。

また、TOWA社員が心身ともに健やかに働ける環境を整えることは、社員やその家族に健康と幸福をもたらし、明るい社会づくりへ繋がると考え、環境整備に取り組んでいます。

健康経営推進体制図

「健康」の木が、少しずつ実をつけ育っていく姿をイメージし『～Let’s grow our healthy tree!～』をスローガンに掲げ、健康推進への取り組みを進めています。



人財育成の戦略について

第一次中期経営計画の基本方針の1つに「多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードする人財の育成を図る」を掲げ、機能別戦略として設定した項目に取り組んでいます。また加えてこれまでの取り組みも引き続き進めてまいります。

第一次中期経営計画の機能別戦略 ～人財・組織戦略～

1. プロセス開発からソリューション提案まで行うTOWA拠点のグローバル展開
2. 次世代をリードするグローバル人財の育成
3. DXによる業務効率化により働き方改革を推進
4. TOWA技術の伝承のためのTOWAアカデミーの創設

基本方針に関する指標および目標

当社は、人的資本への取り組み推進のための指標と目標を次のように設定しています。

指 標	目 標	実績（当連結会計年度）
中途採用者管理職比率	2032年までに35.0%	39.5%
外国人管理職比率	2032年までに10.0%	5.8%
女性管理職比率	2032年までに10.0%	3.5%
健康診断受診率	100.0%を維持	100.0%
BMI（18.5～25未満）	80.0%	67.0%
喫煙率	10.0%	19.4%
ストレスチェック受診率	100.0%を維持	100.0%
総合健康リスク（注）1	90	89
いきいき度（注）2	110	103

表はTOWA単体のみの指標、目標および実績値です。

（注）1 職場のストレスが個人の健康に与える影響を示したスコアであり、厚生労働省が実施した調査データを元に「全国平均＝100」とした偏差値で低いほど良いこととされています。

2 個人と職場の活性度を示したスコアであり、厚生労働省が実施した調査データを元に「全国平均＝100」とした偏差値で高いほど良いこととされています。

人的資本に関する取り組み事例

TOWAアカデミー開校に向けて

2023年4月に『TOWAアカデミー準備室』が発足し、開校に向け準備を進めています。

TOWAアカデミーでは、“TOWAイズムの継承”と“TOWAの技術や技能の継承”に重点を置き、将来に渡り“挑戦し続ける文化の醸成”と“挑戦により変革をもたらす人財の創出”に向けた取り組みを展開していく予定です。

研修・教育

eラーニングを活用し、コンプライアンス教育、輸出管理教育、メンタルヘルス教育、ラインケア研修（対象は管理職）、情報セキュリティ教育、社会人基礎教育（DX基礎等）、法務教育、品質・環境マネジメント自覚教育、SDGs教育などの各種教育を実施。

改善提案制度

経営への参加意識の高揚、研究開発意欲の鼓舞を目的として、経営および業務全般について、社員の改善創意工夫を募る改善提案制度を設けています。

株式給付信託（J-ESOP）の導入

長期ビジョンの実現に向け従業員には高い次元での挑戦が求められます。その成果に報いる観点からインセンティブプランとして本制度を導入しました。従業員自身が株主となることで、企業価値向上に伴う株価向上が従業員の財産形成に繋がります。今後の従業員のエンゲージメント向上に寄与し、当社の持続的な成長に資すると考えています。

社内表彰・褒章制度

勤続年数に応じた勤続表彰や、業績への貢献などに応じた表彰があります。挑戦を称える「チャレンジ賞」、世界の関係会社に授与する「グローバルTOWA賞」も。

定年再雇用制度

2022年3月より、定年以降も定年前と同水準の給与で処遇する再雇用制度を導入し運用しています。従業員が定年後も自立した生活を維持しやすくなり、仕事で活躍することで自己表現や成長できる機会が増すとともに、ノウハウや企業文化の若手社員への伝承促進が期待されます。

DE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）

ダイバーシティ企業への成長を目指して

当社では、年齢・国籍・性別・障がいの有無などの「属性」のダイバーシティに加え、目に見えにくい価値観・経験などで生まれる「視点・思考」を含めたダイバーシティを尊重し、それらを「強み」に変えるグループ全体での仕組みや風土づくりを進めています。

多様な人財づくり

- 多様な価値観の尊重
- 障がい者雇用の拡大
- 女性の活躍促進

S
社会

TOWAグループの社会への取り組み

活動内容・取り組み例

スマートな働き方の推進

TOWA働き方改革ポリシー

社員の価値観やライフスタイルを尊重しサポートすることを目的に、「TOWA 働き方改革ポリシー」を策定しています。当社は、「社員＝ 財産」と捉えて社員一人ひとりの健康と働きがいを第一に考え、働き方改革を重要な経営課題のひとつとして位置づけています。社員の主体性を大切にした同ポリシーは、個々の社員が自身および周囲の働き方を考えることで就業環境の整備や自己成長のチャンスを掴もうとする「自ら変えていく力」を応援しています。

ライフスタイルに応じて活用できる、産休・育休後の職場復帰支援制度

社員が出産や育児をしながらいきいきと仕事を続けていけることが社員の健康、働きがいにつながるものであるととらえる、ライフスタイルに応じて柔軟に活用できる制度づくりと理解ある職場の環境づくりを心掛けています。

今後もより多くの社員が安心して産休・育休を取得でき、会社に復帰した際に社員が働きやすいと感じる温かい環境づくりを推進してまいります。

仕事との両立サポート

育児休職	介護休職
看護	復職

など

TOWAの両立支援行動計画について

当社は、「次世代育成支援対策推進法」ならびに「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、当社の両立支援行動計画を策定し、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」および「女性の活躍推進企業データベース」で行動計画等を公表しています。各計画において、社員への情報提供、実施における課題検討、管理職への研修などを行って施策を推進してまいります。各計画の内容につきましては、厚生労働省の次のサイトをご参照ください。

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
「両立支援総合サイト」 https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動計画
「女性の活躍推進企業データベース」 https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

Topics

健康経営に関する外部評価

「健康経営優良法人2024（大規模法人部門）」（3年連続）、「スポーツエールカンパニー2024」ならびに「きょうと健康づくり実践企業」に認定されました。

健康経営優良法人につきましては、TOWATEC株式会社（中小規模法人部門／2年連続）、TOWAレーザーフロント株式会社（中小規模法人部門／5年連続）も認定をいただいています。

今後も、社員一人ひとりの健康保持・増進、ワーク・ライフ・バランスの向上に取り組み、健康経営を推進してまいります。

健康経営の推進

当社では、健康経営推進の一環として、社員が喜びとやりがいを抱いて仕事に取り組める環境づくりに取り組んでいます。社員一人ひとりの健康保持・増進、ワーク・ライフ・バランスの向上と、安全にいきいきと働くことができる職場環境づくりに取り組み、健康経営を推進してまいります。

TOWA健康宣言

「健(すこやか)漲(みなぎ)りて業(なりわい)壮(さかん)なり」を掲げる健康宣言を策定し、社員全員の健康維持・増進に取り組んでいます。笑顔あふれる職場づくりで社員・家族の健康を目指します。

TOWAクラブ活動・各種会社行事

社員が立ち上げた運動・文化系のクラブ活動に多くの社員が参加しています。活動費の一部を会社が補助することで、個人の負担を軽減し、活動を支援しています。社員の家族が参加できるイベントも開催しています。

8月16日、本社・工場にて「TOWA夏まつり」を開催。午前、午後の部合わせて社員・家族約650名が、ミニ縁日などを楽しみ、夕食会終了後は社屋屋上から五山送り火を観賞しました。

健康経営推進委員会の開催

安全衛生委員会では、3カ月に1回「健康経営推進委員会」を開催して社員の身体と心のケアに努めています。

生活習慣病予防検診の実施

40歳以上の正社員・嘱託社員のうち希望者の定期健康診断に、生活習慣病予防健診(半日人間ドック)を実施しています。

ヘルスケアルームの設置

社員の健康推進と福利厚生を目的としてヘルスキーパー(企業内理療師)を設置しています。理療の国家資格を持ったヘルスキーパーが理療の施術やセルフケア指導、健康への助言などを行っています。またヘルスケアルームから社員に向けた情報発信や、利用しやすい環境整備にも力を入れています。

施術、セルフケア指導の様子

メンタルヘルス支援の「相談窓口」開設

社員の健康保持・増進と会社の生産性向上を目指す取り組みの一つとして、社外カウンセラーによる「相談窓口」を開設しました。仕事やキャリア、こころの健康など、様々な悩みを相談しやすい環境を整備し、こころのケアサポートを行なっています。0次予防(良好状態の維持)、一次予防(未然防止)、二次予防(早期発見)、三次予防(不調者対応)までトータルに働きかけを行う取り組みを広げてまいります。

がん検診費用補助

従業員の健康増進をサポートするためには、がんの早期発見・早期治療が重要であると認識しています。女性に多い病気や、配慮すべき健康リスクなどについて、全社員を対象とした「女性の健康講座」を開催するなど、がんについての正確な情報提供の場を増やしています。さらに、国が推奨する5つのがん検診については、費用を全額当社が負担し、検診受診率のアップに努めています。

「がん対策推進企業アクション」推進パートナー

「がん対策推進企業アクション」推進パートナー企業として登録されました。また、健康経営に関する取り組みを広げるため、当社は企業の女性のがん対策を牽引するプロジェクト「Working RIBBON」に参画しています。

本社・工場のCafeスペースをリニューアルオープン

Caféスペースをくつろぐことができる空間としてリニューアルオープンしました。カジュアルワーキングスペースとしても利用可能とし気分転換やコミュニケーション活性化、従業員のエンゲージメントの向上を図っています。

健康経営への取り組みはこちらからご参照ください。 https://www.towajapan.co.jp/jp/company/health/

S 社会 TOWAグループの社会への取り組み

安心・安全な商品をつくり、届ける

信頼と満足のために追求する最高の品質

ものづくりを事業活動の根幹とする当社は、設計、製造、検査および納品後のアフターサービスまで、すべての工程において一貫した品質を保証するプロセスの構築と改善に取り組んでいます。同時に、最新システムやAIの導入などを通してサービスや業務の質の向上を図っています。

また、品質方針を策定し、これを達成するために、戦略目標を定め、具体的な実現手段を策定し、その成果を定量的に測定する指標を定め、継続的改善に取り組んでいます。

世界の半導体装置市場に製品を供給する当社では、グローバル化に対応した国際的な技術水準での品質保証活動を展開するため、早くから品質保証体制の確立に取り組み、品質保証の国際規格であるISO9001の認証取得を推進してきました。グループの生産拠点においては、ISO9001を株式会社バンディックを除き認証取得しております。なお、医療機器の成形と組立受託製造事業を展開するバンディックでは、医療機器 - 品質マネジメントシステムのISO13485を認証取得しております。

最新技術と高品質の製品を生み出す設備と環境

MS CM008

ISO9001認証（品質）　ISO14001認証（環境）

（坂東記念研究所、INNOMS推進室を除く）

人権の尊重

人権方針

TOWAグループは、自らの事業活動において、影響を受けるすべての人々の人権が尊重されなければならないことについて理解を深め、策定した人権方針に基づき、適切に活動してまいります。

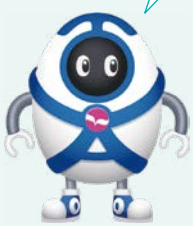
人権方針につきましてはこちらのウェブサイトをご参照ください。

https://www.towajapan.co.jp/jp/company/humanrights/

Topics 「トワッピー」誕生

長期ビジョン「TOWA ビジョン2032」達成に向けたメッセージを広く内外に発信するため、キャラクター「トワッピー」の制作と、ビジュアルコンセプトメッセージ「Happy Tech Happy World」を制定いたしました。長期ビジョン実現に向けて、採用などの人財確保や、BtoCを視野に入れた新たな事業展開を見据えて、知名度の高い会社を目指してまいります。

なまえ	トワッピー
なまえの由来	TOWA発で世界にハッピーを届けます
住んでいるところ	京都
身長	100.1cm
誕生日	4月17日（TOWA創立記念日）
使命	半導体を核として、世界中の人々に幸せを届ける
夢	Happy Tech を次々と生み出し幸せを実感できる世界に貢献すること
好きな言葉	チャレンジ！

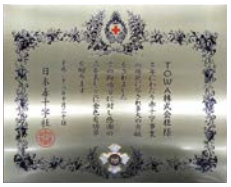


展示会ブース準備の様子（京都ビジネス交流フェア2024）

社会貢献活動

社内献血の実施

毎年春季と夏季の2回、社員等を対象とした献血事業への協力を継続しています。当社の長年にわたる献血事業への理解と協力に対し、日本赤十字社から、「銀色有功章」と「金色有功章」を授与されました。これからも輸血を必要とする世界中の人々を支えていくために、日本赤十字社と協力し、積極的に献血活動の普及、啓発に取り組んでまいります。



日本赤十字社の「金色有功章」

交通マナーを高める事故防止コンクール「金賞」受賞

2023年7月から9月に実施された「交通マナーを高める事故防止コンクール（セーフティラリー京都）」において金賞を受賞しました。

この金賞は、参加チームの無事故・無違反の達成状況および交通安全活動に対する取り組み状況が特に優秀であった事業所に授与されるものです。当社は、セーフティラリーに継続的に参加しているほか、交通安全活動として、全日本交通安全協会などが実施する「交通安全年間スローガン」募集に毎年参加するなど交通安全に対する啓発、意識向上に努めています。

交通マナーを高める事故防止コンクール「金賞」

39矢野基金への協力

当社は、元阪神タイガース監督の矢野燿大氏による「39（サンキュー）矢野基金」活動に賛同し、売上の一部が筋ジストロフィー症患者の方や児童養護施設の子供たちへの支援金となる「応援自動販売機」を設置しています。2015年に設置した「応援自動販売機」は京都での設置第一号となりました。

本社・工場に設置の応援自動販売機

コミュニティ・行事への協賛と情報発信

コミュニティへの貢献と知名度の高い会社を目指して

長期ビジョン「TOWAビジョン2032」のありたい姿に掲げた「積極的な情報発信で知名度の高い会社」を目指し、コミュニティや行事への参画・協賛と情報発信に努めています。2023年度の取り組みを紹介します。

ハンケイ500m

京都で配布されているフリーマガジン「ハンケイ500m」に、当社社長のインタビュー記事「岡田博和ものがたり」（全10回、2022年5月～2023年11月）が掲載されました。

TOWA学生演劇フェスティバル

京都の学生演劇を応援するポータルサイト「学生演劇応援団」に協賛しています。前年始動した「TOWA学生演劇アワード」は、「TOWA学生演劇フェスティバル」として2024年2月26日に鴨沂会館で開催されました。

ものづくり太郎さまとのコラボ

YouTubeやご講演など、ものづくりや技術力に強みを持つ業界・企業についての情報発信を通して、日本の製造業を盛り上げるための活動に注力されているものづくり太郎さまの動画にてTOWAをピックアップしていただきました。ChatGPTや生成AIを切り口に、当社の技術の強みが取り上げられました。

YouTube ものづくり太郎チャンネル **https://www.youtube.com/@monozukuritarou**

『ChatGPTの衝撃 AIブームで「次くる半導体」はこれです。ある方法で予測可能。』（2023年9月1日）

https://youtu.be/PloQ2IB0zOM

G
ガバナンス

TOWAグループのコーポレートガバナンス

高度なコーポレートガバナンスを実現するために

当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンス体制の充実を図っています。

当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの一層の強化と実践に努めています。

1. 当社グループの行動が法と社会倫理に基づいていること
2. 経営の透明性、客観性を確保し維持すること
3. 環境の変化に迅速に対応できる組織・体制を構築すること
4. 株主の権利の保護や平等性の確保など株主重視の公正な経営を徹底していくこと
5. ステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値や雇用を創造すること

コーポレートガバナンスシステム

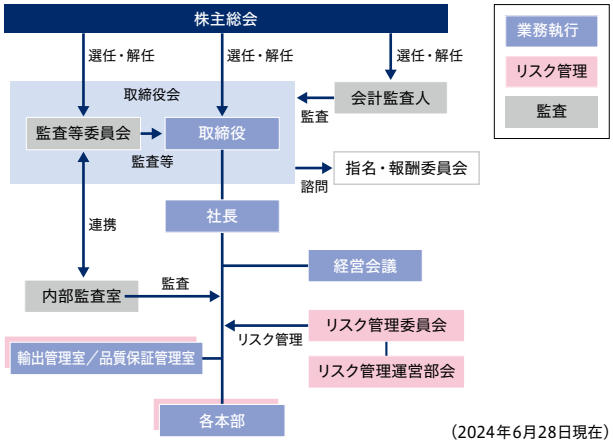
当社の主な取り組み内容は以下のとおりです。

取締役会の機能強化について

当社は取締役会の機能強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により経営の効率性を高める目的から、2016年6月より監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役１名、監査等委員である社外取締役3名の計4名（男性2名、女性２名）で構成しており、内部監査室及び会計監査人と緊密に連携をとることで必要な情報の共有化を図っています。

コーポレートガバナンス体制図



（2024年6月28日現在）

取締役会の概要

取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）5名と監査等委員4名（うち3名は独立社外取締役）で構成されており、代表取締役社長 岡田博和を議長とし、月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しています。

取締役会の概要と活動状況

構成	取締役9名（うち社外取締役3名）
2023年度開催実績	17回
主な決議事項	株主総会に関する事項、決算に関する事項、役員報酬に関する事項、予算・事業計画に関する事項、人事・組織に関する事項、資金に関する事項、子会社に関する事項、サステナビリティ・ESGに関する事項、重要な社内規程の改廃に関する事項等
主な報告事項	取締役会実効性評価に関する報告、業務執行状況に関する報告、月次業績に関する報告、監査に関する報告、利益相反取引に関する報告等

取締役会の実効性の状況としましては、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査を行い、取締役会の現状について正しく理解し、より実効性の高い運営をしています。取締役会は毎年1回、取締役全員を対象としたアンケート(自己評価)を実施し、取締役会の実効性の分析・評価を行っています。

結果につきましては、取締役会は、社外役員の意見・質問も含め、各自が自由な意見が述べられ、充実した議論が行われていること、また、取締役会の開催頻度や時間、審議項目の数や内容等の運営についても適切・十分になされているとの評価を受けており、実効性が確保されていることを確認しています。また、アンケート結果や意見について取締役会で議論を行っており、取締役会のさらなる実効性の向上に向けて取り組んでいます。

取締役会の構成につきましては、重要な経営判断と業務執行の監督が適切なバランスとなるよう、取締役に必要な経験・知見・能力を特定した上で、その構成や多様性等を考慮しています。取締役の主たる経験分野・専門性を記載したスキルマトリックスにつきましては、56ページの「役員一覧」をご参照ください。

任意の委員会について

取締役の人事および報酬制度における審議プロセスの公正性、透明性および客観性を高め、コーポレートガバナンスの充実を図るため、2021年4月1日付で取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を発足いたしました。当委員会は、独立社外取締役3名と、代表取締役1名および管理本部担当取締役1名の計5名で構成されており、議長は独立社外取締役が務めています。

指名・報酬委員会

			2023年度開催実績
議長	取締役監査等委員(社外)	和氣 大輔	3回
委員	代表取締役社長 取締役上席執行役員(経営企画本部・管理本部担当) 取締役監査等委員(社外) 取締役監査等委員(社外)	岡田 博和 柴原 信隆 後藤 美穂 田中 素子	

監査等委員会について

監査等委員会は、取締役 服部広志の1名と社外取締役 和氣大輔、後藤美穂、田中素子の3名で構成されています。監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査方針・監査計画及び業務分担、監査報告の作成、会計監査人に関する評価、監査等委員である取締役以外の取締役の人事・報酬についての意見形成、常勤監査等委員の職務執行状況報告等です。2023年度、監査等委員会は17回開催しています。

リスクマネジメント

社内のリスク管理の最高機関として、社長を議長とする「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスクの抽出や評価を実施しています。当委員会の下には複数のリスク管理分科会が設置されており、テーマごとに内部統制、輸出管理、品質保証等におけるリスクを毎月ウォッチしています。これらの分科会の活動状況は4半期ごとに取締役会で報告され社外取締役も内容を確認しています。

G
ガバナンス

TOWAグループのコーポレートガバナンス

事業等のリスクについて

当社グループは、半導体や医療機器など現代社会に不可欠な最終製品を支える重要な役割を担い、また半導体事業を中心にグローバルで事業を展開していることから多様なリスクに晒されています。投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として下表の項目を抽出しています。これらのリスクの説明や対応は、有価証券報告書「事業等のリスク」に詳細を掲載していますのでご参照ください。なお、これらのリスクは当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、また当社グループに関するリスクを網羅したものではありません。

https://www.towajapan.co.jp/jp/download_file/view/3188/220/

リスク項目

(1)販売に関するリスク
- ① 経済及び半導体市場の動向によるリスク
- ② 価格競争に関するリスク
- ③ 販売先や地域の集中に関するリスク

(2)生産に関するリスク
- ① 海外展開に伴うリスク
- ② 自然災害等のリスク
- ③ 原材料等の調達に関するリスク

(3)開発に関するリスク
- ① 新製品の開発リスク
- ② 知的財産に関するリスク

(4)人財の採用や育成に関するリスク

(5)財務に関するリスク
- ① 為替リスク
- ② 有利子負債に関するリスク
- ③ 固定資産の減損処理に関するリスク

(6)情報セキュリティに関するリスク

(7)気候変動に関するリスク

コンプライアンスの取り組み

内部通報制度

社員相談窓口として総務部が専用メールアドレスを設けており、社員は直接通報や相談ができる仕組みを整えています。女性社員専用のメールアドレスも設けており、担当の女性社員に直接届くようになっています(電子メール以外の面会等による方法も可能です)。調査委員会が調査を行い、必要に応じて社外の専門家等にも相談いたします。なお、公益通報者が不利益を被らないよう社内規程で定め配慮しています。

腐敗行為の防止

当社グループは、「腐敗防止方針」に基づき、贈収賄、横領、利益供与の強要、不正入札等の、自己または第三者の職務上の権力や地位の濫用といった腐敗行為、また、それに加担する行為である司法妨害、資金洗浄等の防止の徹底に努めています。

「腐敗防止方針」につきましては、下記のウェブサイトをご参照ください。

https://www.towajapan.co.jp/jp/company/anticorruption/

社内教育

法令や社会規範を遵守して事業活動および会社生活を営むうえで必要となる知識を、主にeラーニングを通じて社員に徹底しています。階層別で受講するWeb通信教育講座でもCSR・コンプライアンス関連の講座を設けています。定期的に実施することにより社員の知識・意識の定着を図っています。

〈実施している教育の例〉
コンプライアンス教育、輸出管理教育、ハラスメント研修、メンタルヘルス教育、情報セキュリティ教育、環境教育

コーポレートガバナンス強化・企業価値向上に向けた取り組み

コーポレートガバナンス強化への主な実施項目

取締役会の機能強化に向けて

取締役会の機能強化と多様性を高める目的から2022年6月より、女性役員を1名増員し2名といたしました。これにより女性役員比率は22%となりました。

有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示推進

企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正の内容に基づき、サステナビリティ情報の開示を推進しています。サステナビリティに関する体制の整備や取り組みを進め、情報開示の充実化を図ってまいります。

知的財産方針の策定

国内外知的財産の更なる強化や、他社権利侵害等のリスク対策に関する基本方針として、2023年6月に「知的財産方針」を策定しました。発明・創作の活性化を図るとともに、全社知財・統制管理の強化のために活動範囲を全社グループに拡大し、適切な知財管理体制の構築を進めてまいります。

「知的財産方針」につきましては、下記のウェブサイトをご参照ください。

https://www.towajapan.co.jp/jp/company/ip/

政策保有株式の縮減について

当社は、持続的な成長と中長期的な成長を図るため、業務提携、資金調達、取引拡大など経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を保有することがあります。保有する株式については、保有目的が適切か、保有にともなう便益やリスクが資本コストに見合っているか等を定期的に検証するとともに、検証結果を踏まえ、取締役会で保有継続の可否等について判断いたします。保有する意義の乏しいと判断される銘柄については、市場動向や考慮すべき事情に配慮しつつ売却を行います。なお、コーポレートガバナンス・コードが導入された2015年6月以降、6銘柄を売却いたしました。引き続き、保有する意義の乏しいと判断される銘柄については、売却等について検討を進めてまいります。

議決権の行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかどうか、また当社への影響などを総合的に判断して適切に行使いたします。

その他、詳細につきましては下記コーポレートガバナンスのウェブサイトをご参照ください。

https://www.towajapan.co.jp/jp/company/governance/

IR・SR活動について

当社は、アナリスト、機関投資家、個人投資家等のステークホルダーの皆様との対話を積極的に実施し、当社の考えや状況を説明するとともに、いただいたご意見は経営陣にて共有し、企業価値向上に取り組んでいます。

IR・SR活動内容	2024年3月期実績
決算説明会・記者会見（CEO対応）	4回
機関投資家・アナリストとの個別面談	約330回
海外機関投資家向けカンファレンス参加	3回

このほかにも、本社・工場において2023年12月～2024年1月にかけて開催した「技術展」にて顧客や機関投資家・アナリスト、金融機関向けにTOWAの製品や技術の紹介を実施。

役員一覧

取締役

代表取締役社長
岡田 博和

取締役常務執行役員
石田 耕一

コア技術事業本部・開発本部担当

取締役上席執行役員
柴原 信隆

経営企画本部・管理本部担当

取締役執行役員
西村 一洋

生産本部担当

取締役執行役員
三浦 宗男

営業本部・シンギュレーション事業本部担当

取締役常勤監査等委員
服部 広志

取締役監査等委員（社外）
和氣 大輔

和氣公認会計士事務所所長
シライ電子工業株式会社
社外取締役監査等委員

取締役監査等委員（社外）
後藤 美穂

後藤総合法律事務所弁護士

取締役監査等委員（社外）
田中 素子

田中公認会計士事務所所長
株式会社ワコールホールディングス
社外監査役

執行役員

上席執行役員 フェロー
早坂 昇
TOWAレーザーフロント株式会社
代表取締役社長

上席執行役員
鈕 方舜
東和半導体設備(上海)有限公司
董事長総経理

上席執行役員
韓 相倫
TOWA韓国株式会社 代表理事

執行役員
笹田 秀典
TOWATEC株式会社 代表取締役社長

執行役員
中西 和彦
経営企画本部長 兼 秘書室長 兼
INNOMS推進室長

執行役員
寺内 利浩
株式会社バンディック 代表取締役社長

スキルマトリックス

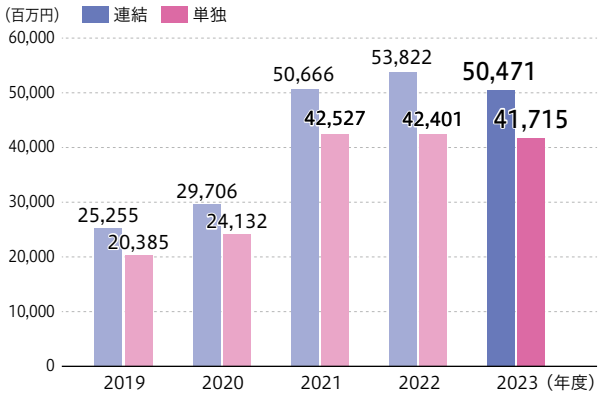
	地位・役職	社外	独立	指名報酬委員会	企業経営	生産技術開発	海外駐在経験	営業マーケティング	会計	法務コンプライアンス
岡田 博和	代表取締役社長			○	●	●	●	●		
石田 耕一	取締役常務執行役員					●		●		
柴原 信隆	取締役上席執行役員			○	●		●			●
西村 一洋	取締役執行役員				●	●	●			
三浦 宗男	取締役執行役員						●	●		
服部 広志	取締役常勤監査等委員								●	
和氣 大輔	取締役監査等委員	○	○	◎					●	
後藤 美穂	取締役監査等委員	○	○	○						●
田中 素子	取締役監査等委員	○	○	○					●	

◎は委員長

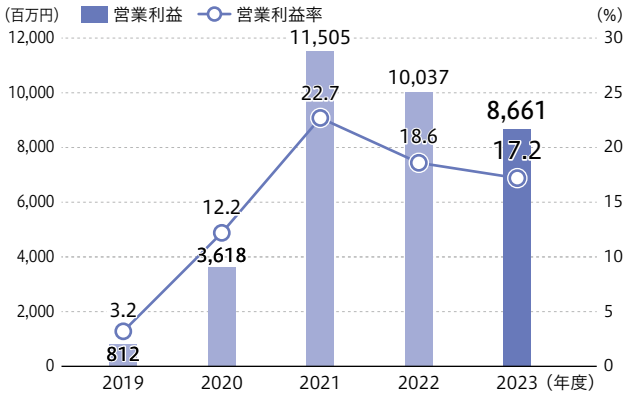
財務・非財務ハイライト

財務ハイライト

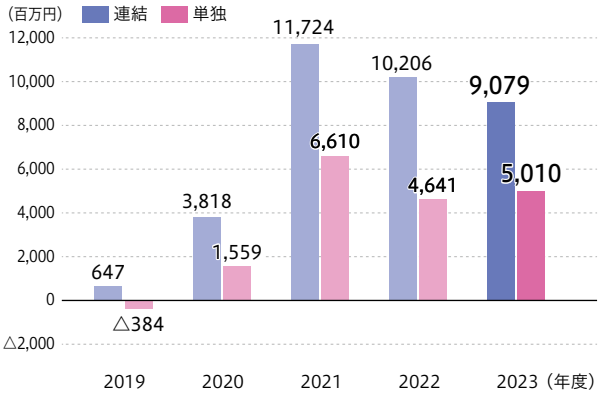
売上高



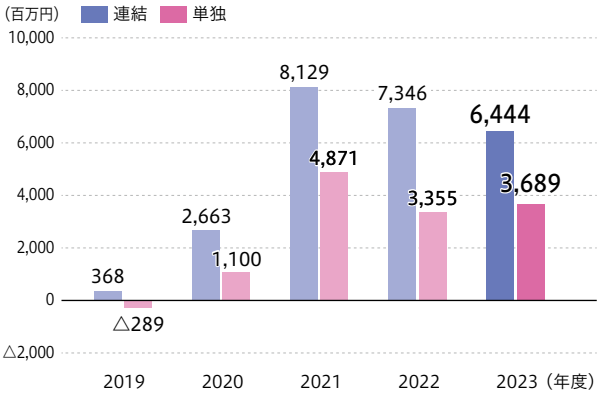
営業利益／営業利益率（連結）



経常利益

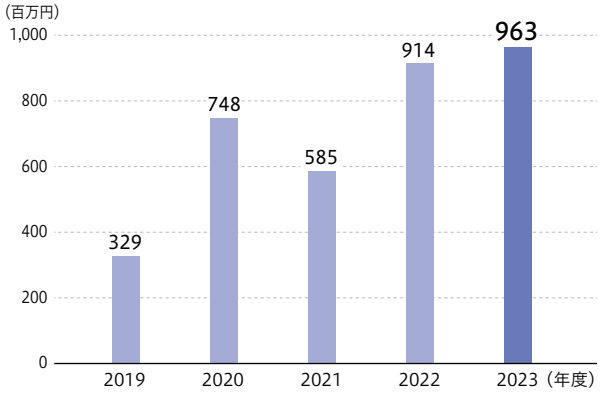


当期純利益

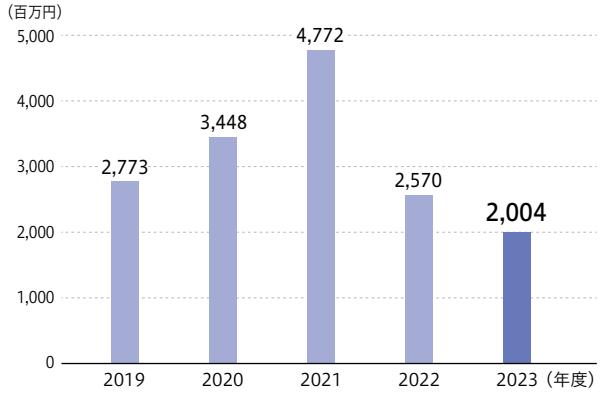


※連結については、親会社株主に帰属する当期純利益を記載しております。

研究開発費（連結）

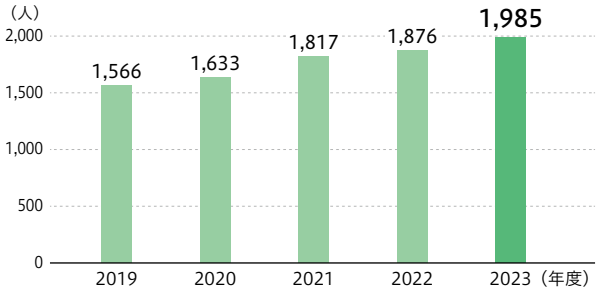


設備投資（連結）



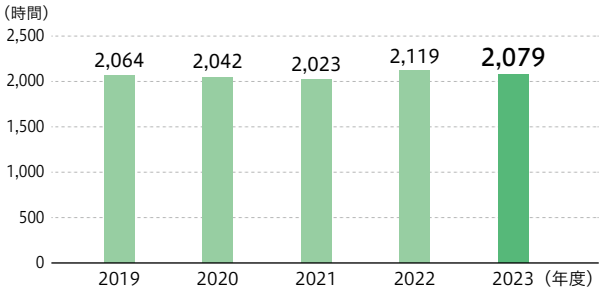
非財務ハイライト

連結従業員数



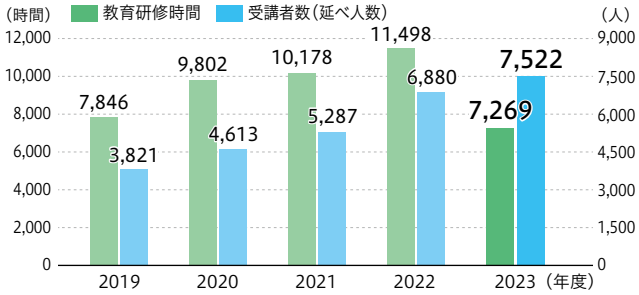
※正社員と嘱託社員の合計を期末時点にて算出

一人当たりの総労働時間数



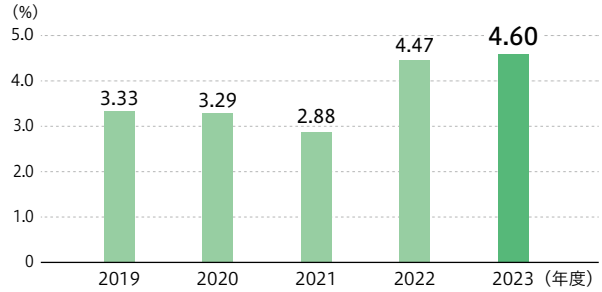
※TOWA単体を算出　※期中退職者・休職者・出向者除く

教育研修時間と受講者数



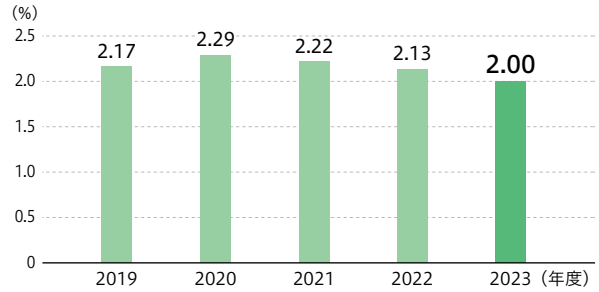
※TOWA単体における全社共通の研修のみ集計

正社員の離職率



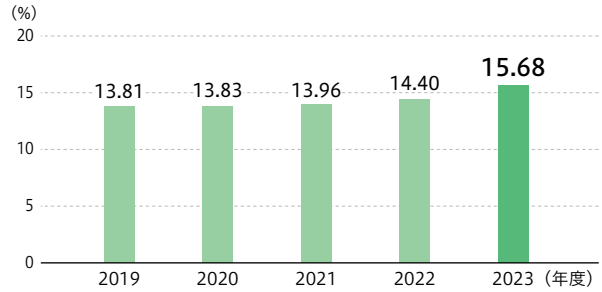
※期末時点までの退職者÷期初の人数×100にて算出（退職者に定年退職者は含めない）　※TOWA単体を算出

障がい者雇用率



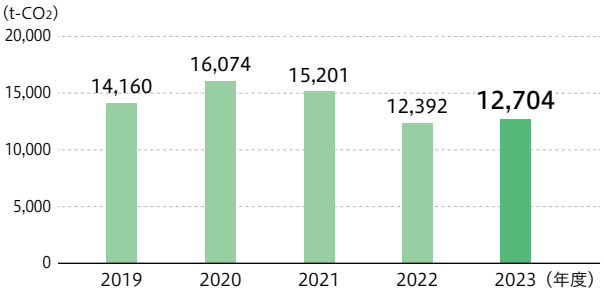
※年間通じての実雇用率にて算出　※TOWA単体を算出

女性従業員割合



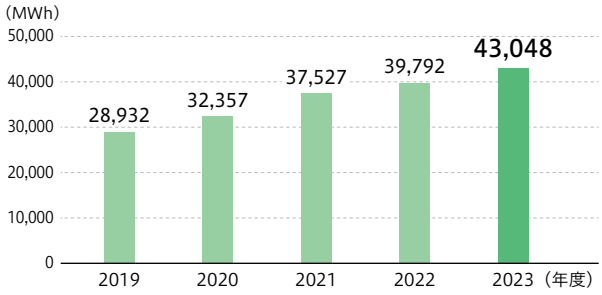
※期末時点にて算出　※TOWA単体を算出

CO_2排出量



国内のグループ会社を含む5つの拠点と、海外グループ会社の6つの生産拠点の合計。CO_2への換算係数は、国内は環境省の「電気事業者別排出係数一覧」、海外はIEA発行のEmissions Factorsを使用。燃料は、国内ガス会社の公表値、および環境省の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を使用。

電力使用量



国内のグループ会社を含む5つの拠点と、海外グループ会社の6つの生産拠点の合計。

連結貸借対照表

（単位：千円）

資産	2023年3月期	2024年3月期
流動資産		
現金及び預金	16,547,017	20,830,999
受取手形	73,070	86,464
電子記録債権	1,201,865	345,054
売掛金	11,693,703	15,049,199
商品及び製品	3,872,313	4,110,721
仕掛品	10,004,429	10,041,146
原材料及び貯蔵品	1,530,325	1,699,212
その他	1,040,268	1,550,660
貸倒引当金	△2,781	△2,363
流動資産合計	45,960,213	53,711,096
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	20,972,307	22,106,434
減価償却累計額	△12,280,703	△13,065,298
建物及び構築物（純額）	8,691,604	9,041,135
機械装置及び運搬具	16,075,149	17,554,193
減価償却累計額	△10,707,731	△11,954,563
機械装置及び運搬具（純額）	5,367,418	5,599,630
土地	5,205,569	5,289,066
リース資産	1,303,520	1,594,823
減価償却累計額	△295,608	△440,008
リース資産（純額）	1,007,912	1,154,815
建設仮勘定	240,647	232,675
その他	4,490,065	4,852,823
減価償却累計額	△3,643,421	△4,002,437
その他（純額）	846,644	850,385
有形固定資産合計	21,359,797	22,167,709
無形固定資産		
その他	1,162,199	1,329,271
無形固定資産合計	1,162,199	1,329,271
投資その他の資産		
投資有価証券	3,929,663	9,244,703
繰延税金資産	373,528	445,334
退職給付に係る資産	381,509	641,147
その他	301,641	322,569
投資その他の資産合計	4,986,343	10,653,756
固定資産合計	27,508,339	34,150,736
資産合計	73,468,553	87,861,833

負債及び純資産	2023年3月期	2024年3月期
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,411,521	3,834,249
電子記録債務	46,368	36,252
短期借入金	9,400,000	9,400,000
1年内返済予定の長期借入金	1,930,000	1,560,000
リース債務	133,150	149,506
未払法人税等	740,224	1,827,856
前受金	1,882,461	2,598,098
賞与引当金	983,530	986,299
役員賞与引当金	98,219	98,443
製品保証引当金	314,644	307,882
その他	1,807,644	2,399,211
流動負債合計	19,747,763	23,197,801
固定負債		
長期借入金	3,950,000	2,490,000
リース債務	460,387	419,819
繰延税金負債	848,444	2,330,034
退職給付に係る負債	810,914	933,297
株式給付引当金	–	40,497
その他	27,788	14,479
固定負債合計	6,097,535	6,228,128
負債合計	25,845,298	29,425,930
株主資本		
資本金	8,942,950	8,955,671
資本剰余金	472,558	450,981
利益剰余金	32,916,324	38,359,732
自己株式	△13,436	△115,191
株主資本合計	42,318,396	47,651,194
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,312,590	6,013,298
為替換算調整勘定	2,570,638	4,642,014
退職給付に係る調整累計額	20,003	129,394
その他の包括利益累計額合計	4,903,232	10,784,708
非支配株主持分	401,624	–
純資産合計	47,623,254	58,435,903
負債純資産合計	73,468,553	87,861,833

連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（単位：千円）

連結損益計算書	2023年3月期	2024年3月期
売上高	53,822,668	50,471,799
売上原価	35,014,116	32,273,620
売上総利益	18,808,551	18,198,179
販売費及び一般管理費	8,771,449	9,536,350
営業利益	10,037,101	8,661,829
営業外収益		
受取利息	42,429	145,619
受取配当金	87,377	282,068
雑収入	219,716	228,066
営業外収益合計	349,522	655,754
営業外費用		
支払利息	70,188	71,787
貸与資産減価償却費	29,694	30,397
為替差損	55,257	120,986
雑損失	25,430	14,677
営業外費用合計	180,569	237,849
経常利益	10,206,054	9,079,734
特別利益		
固定資産売却益	389	35,135
固定資産受贈益	–	23,200
特別利益合計	389	58,335
特別損失		
固定資産売却損	5,062	–
固定資産除却損	17,944	10,209
投資有価証券評価損	–	12,786
特別損失合計	23,006	22,995
税金等調整前当期純利益	10,183,438	9,115,073
法人税、住民税及び事業税	2,314,284	2,942,089
法人税等調整額	516,675	△271,208
法人税等合計	2,830,959	2,670,880
当期純利益	7,352,478	6,444,193
非支配株主に帰属する当期純利益	5,801	–
親会社株主に帰属する当期純利益	7,346,676	6,444,193

（単位：千円）

連結包括利益計算書	2023年3月期	2024年3月期
当期純利益	7,352,478	6,444,193
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	50,944	3,700,708
為替換算調整勘定	403,931	2,071,376
退職給付に係る調整額	△74,936	109,390
その他の包括利益合計	379,939	5,881,475
包括利益	7,732,418	12,325,668
（内訳）		
親会社株主に係る包括利益	7,723,433	12,325,668
非支配株主に係る包括利益	8,984	–

連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

連結キャッシュ・フロー計算書	2023年3月期	2024年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	10,183,438	9,115,073
減価償却費	2,498,249	2,540,701
のれん償却額	116,704	146,567
貸倒引当金の増減額（△は減少）	932	△641
賞与引当金の増減額（△は減少）	82,554	△17,175
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	18,692	△1,688
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△67,820	6,952
株式給付引当金の増減額（△は減少）	–	40,497
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△54,774	△9,671
受取利息及び受取配当金	△129,806	△427,687
支払利息	70,188	71,787
為替差損益（△は益）	△86,015	66,833
売上債権の増減額（△は増加）	△3,918,031	△1,476,948
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,373,923	96,607
その他の流動資産の増減額（△は増加）	89,009	△43,896
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,356,803	1,193,242
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△322,444	348,150
その他	305,321	△339,832
小計	6,803,317	11,308,874
利息及び配当金の受取額	128,981	258,150
利息の支払額	△69,393	△73,066
法人税等の支払額	△4,044,163	△1,906,869
法人税等の還付額	12,486	78,790
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,831,227	9,665,880
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△248,012	△505,352
定期預金の払戻による収入	290,637	322,857
その他の投資に係る支出	△4,588	△4,589
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,731,421	△1,668,564
有形及び無形固定資産の売却による収入	14,050	35,612
事業譲受による支出	–	△933,600
その他	△66,677	△20,128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,746,012	△2,773,764
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,100,000	–
長期借入れによる収入	3,000,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△1,730,000	△1,930,000
自己株式の取得による支出	△704	△101,754
配当金の支払額	△1,250,430	△1,000,785
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	–	△435,922
その他	△156,650	△155,902
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,962,214	△3,524,364
現金及び現金同等物に係る換算差額	132,607	719,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,180,037	4,086,775
現金及び現金同等物の期首残高	12,250,459	16,430,497
現金及び現金同等物の期末残高	16,430,497	20,517,272

グローバルネットワーク

- 生産拠点
- 販売拠点
- サービス拠点
- トレーニングセンター
- ラボラトリ

TOWA株式会社

①本社・工場
②京都東事業所
③九州事業所
④東京営業所
⑤長野営業所

①本社・工場

②京都東事業所

③九州事業所

⑥バンディック

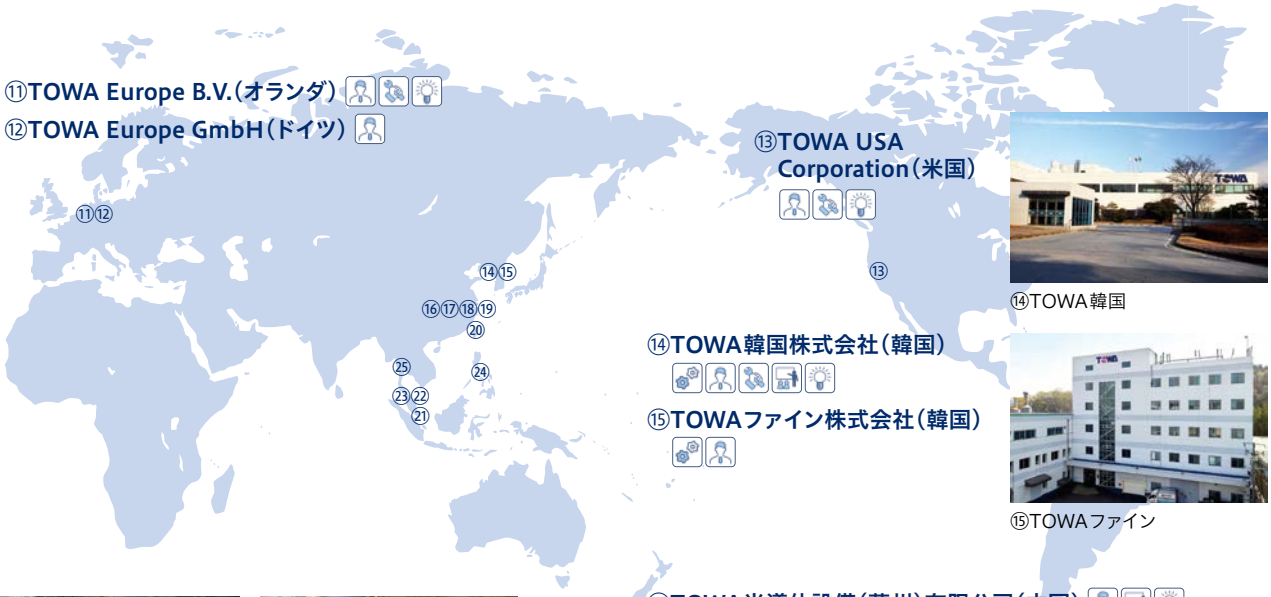
⑥株式会社バンディック

TOWATEC株式会社

①本社
③九州サービス
⑦東北サービス

TOWAレーザーフロント株式会社

⑧本社・工場
⑨中部営業所
⑩関西営業所



⑪TOWA Europe B.V.（オランダ）
⑫TOWA Europe GmbH（ドイツ）

⑬TOWA USA Corporation（米国）

⑭TOWA韓国

⑭TOWA韓国株式会社（韓国）
⑮TOWAファイン株式会社（韓国）

⑮TOWAファイン

⑯TOWA半導体設備（蘇州）

⑱東和半導体設備（南通）

㉒TOWAM

㉓TOWA TOOL

⑯TOWA半導体設備（蘇州）有限公司（中国）
⑰東和半導体設備（上海）有限公司（中国）
⑱東和半導体設備（南通）有限公司（中国）
⑲東和半導体設備研究開発（蘇州）有限公司（中国）

⑳台湾東和半導体設備股份有限公司（台湾）

㉑TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd.（シンガポール）
㉒TOWAM Sdn. Bhd.（マレーシア）
㉓TOWA TOOL SDN. BHD.（マレーシア）
㉔TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.（フィリピン）
㉕TOWA THAI COMPANY LIMITED（タイ）

会社概要（2024年3月31日現在）

会社情報

商号	TOWA株式会社 （英文名TOWA CORPORATION）
設立	1979年4月17日
資本金	8,955,671,632円
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎（075）692-0250（代表）
従業員数	623名（単体） 1,985名（連結）
ホームページ	https://www.towajapan.co.jp
上場取引所	東京証券取引所プライム市場

TOWAグループ

国内

TOWA株式会社
　本社・工場
　京都東事業所
　九州事業所
株式会社バンディック
TOWATEC株式会社
TOWAレーザーフロント株式会社

海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd.（シンガポール）
TOWAM Sdn. Bhd.（マレーシア）
TOWA TOOL SDN. BHD.（マレーシア）
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.（フィリピン）
TOWA THAI COMPANY LIMITED（タイ）
TOWA USA Corporation（米国）
TOWA Europe B.V.（オランダ）
TOWA Europe GmbH（ドイツ）
TOWA半導体設備（蘇州）有限公司（中国）
東和半導体設備（上海）有限公司（中国）
東和半導体設備（南通）有限公司（中国）
東和半導体設備研究開発（蘇州）有限公司（中国）
台湾東和半導体設備股份有限公司（台湾）
TOWA韓国株式会社（韓国）
TOWAファイン株式会社（韓国）

株式情報

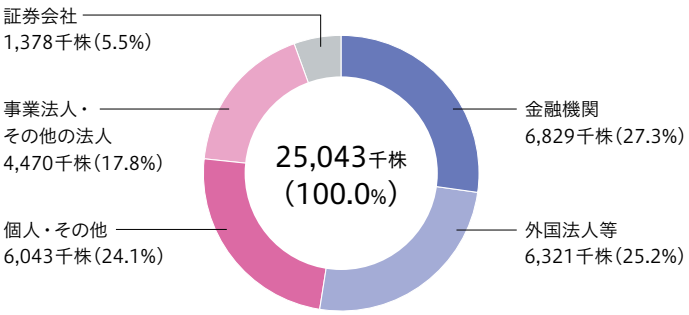
発行可能株式総数	80,000,000株
発行済株式の総数	25,043,888株
株主数	19,871名
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
定時株主総会	毎年6月
基準日	株主総会権利行使および期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
郵便物の郵送先及び電話お問い合わせ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-288-324（フリーダイヤル）
未払い配当金のお支払	みずほ信託銀行 本店および全国各支店 みずほ銀行 本店および全国各支店
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL https://www.towajapan.co.jp

大株主

株主名	持株数（千株）	持株比率（%）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	3,139	12.54
株式会社日本カストディ銀行	2,417	9.66
株式会社ケイビー恒産	1,900	7.59
株式会社エヌレガロ	1,260	5.03
MORGAN STANLEY & CO. LLC	1,060	4.24
株式会社京都銀行	699	2.80
GOLDMAN,SACHS & CO.REG	419	1.67
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT	374	1.50
TOWA社員持株会	341	1.37
JPモルガン証券株式会社	257	1.03

（注1）日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の持株数は信託業務に係るものです。
（注2）持株比率は、自己株式（14,179株）を控除して計算しております。

所有者別株式数分布



TOWA株式会社
〒601-8105　京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地
https://www.towajapan.co.jp

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。